

ULVAC

株式会社 アルバック

# 決算説明資料

2021年度 2021年7月~2022年6月

---

2022年8月10日

証券コード：6728

Breakthrough 2022

## 将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

## 1. 21年度実績：受注高・売上高・営業利益は前年同期・計画を上回る

**受注高** 2,701億円（前年同期比+36%）

- ・ 半導体・電子：ロジック・メモリ・パワーデバイス・各種電子デバイス投資活発化
- ・ FPD：ITパネル用LCD投資活発化

**売上高** 2,413億円（前年同期比+32%）

- ・ 部品長納期化等の影響はあるものの受注高増加により大幅増加

**営業利益** 301億円（前年同期比+75%）

- ・ 売上総利益率は**30.6%**（**上場来最高水準**）
- ・ 営業利益率は12.5%（前年同期比+3.1pt）に改善

**配当予想** 期末配当を当初予想110円から**124円に増配**（20年度実績比+29円）

【単位：億円】	FY20	FY21	前年同期比	FY21計画	計画比
受注高	1,989	<b>2,701</b>	<b>+36%</b>	2,450 (21/8 : 2,300)	<b>+10%</b>
売上高	1,830	<b>2,413</b>	<b>+32%</b>	2,100	<b>+15%</b>
営業利益	172	<b>301</b>	<b>+75%</b>	265	<b>+13%</b>

2. 中期経営計画：半導体・電子を中心に成長を実現  
部材長納期化等の影響あるも、モノづくり力強化により利益率改善

3. 22年度計画：受注高2,700億円、売上高2,500億円、営業利益345億円の計画

配当予想

22年度配当予想は141円（21年度比+17円）

【単位：億円】	FY21実績	FY22計画	増減率
受注高	2,701	2,700	-
売上高	2,413	2,500	+4%
営業利益	301	345	+15%

4. 23年度以降：次期中期経営計画を策定し23年8月に公表予定  
成長分野に開発投資を集中し、増収増益・利益率向上を図る方針

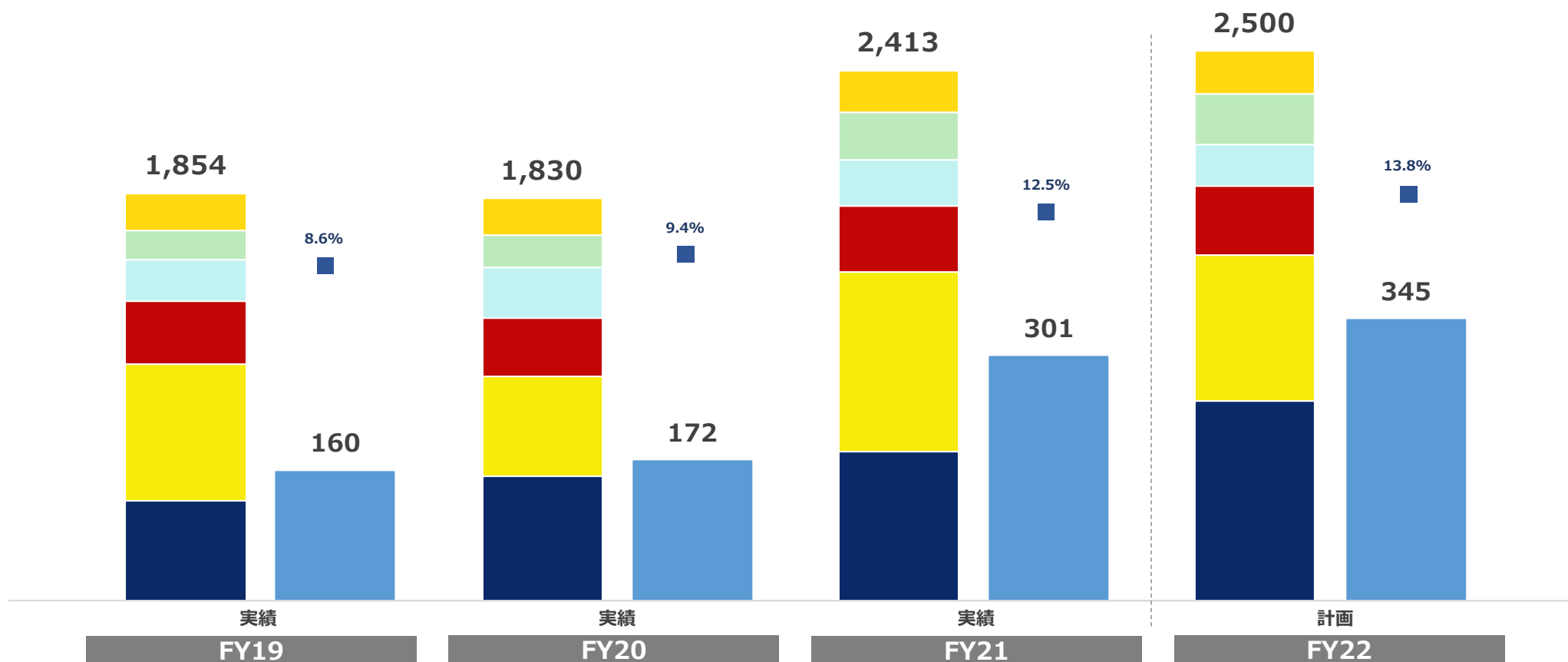
# 中期経営計画実績推移・22年度計画

- 21年度の売上高**2,413億円 (+582億円)**・**営業利益301億円 (+129億円)** は前年同期を大きく上回る
- 22年度の売上高は**2,500億円 (半導体・電子が大きく成長)**、**営業利益は345億円**の計画

## 売上高・営業利益 (率)

【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料    ■ 営業利益  
■ FPD製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他    ■ 営業利益率





# 2021年度 連結業績

# 1. 2021年度 業績概要

- 受注高：半導体・電子・FPD投資活発化等により、前年同期比**36%増加**、計画比**10%増加**
- 売上高：前年同期比**32%増加**、計画比**15%増加**、営業利益：前年同期比**75%増加**、計画比**13%増加**
- 営業利益率：**12.5%**（前年同期比**+3.1pt**）に改善

【単位：億円】	2020年度		2021年度				
	実績	※計画	実績	前年同期比		計画比	
受注高	1,989	2,450	<b>2,701</b>	+712	<b>+36%</b>	+251	+10%
売上高	1,830	2,100	<b>2,413</b>	+582	<b>+32%</b>	+313	+15%
売上総利益	538	-	<b>737</b>	+200	<b>+37%</b>	-	-
率	29.4%	31.9%	<b>30.6%</b>	+1.2pt	-	-1.3pt	-
販管費	366	-	<b>437</b>	+71	<b>+19%</b>	-	-
営業利益	172	265	<b>301</b>	+129	<b>+75%</b>	+36	+13%
率	9.4%	12.6%	<b>12.5%</b>	<b>+3.1pt</b>	-	-0.2pt	-
経常利益	180	270	<b>322</b>	+142	<b>+79%</b>	+52	+19%
率	9.8%	12.9%	<b>13.3%</b>	+3.5pt	-	0.5pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	148	180	<b>202</b>	+54	<b>+36%</b>	+22	+12%
率	8.1%	8.6%	<b>8.4%</b>	0.3pt	-	-0.2pt	-

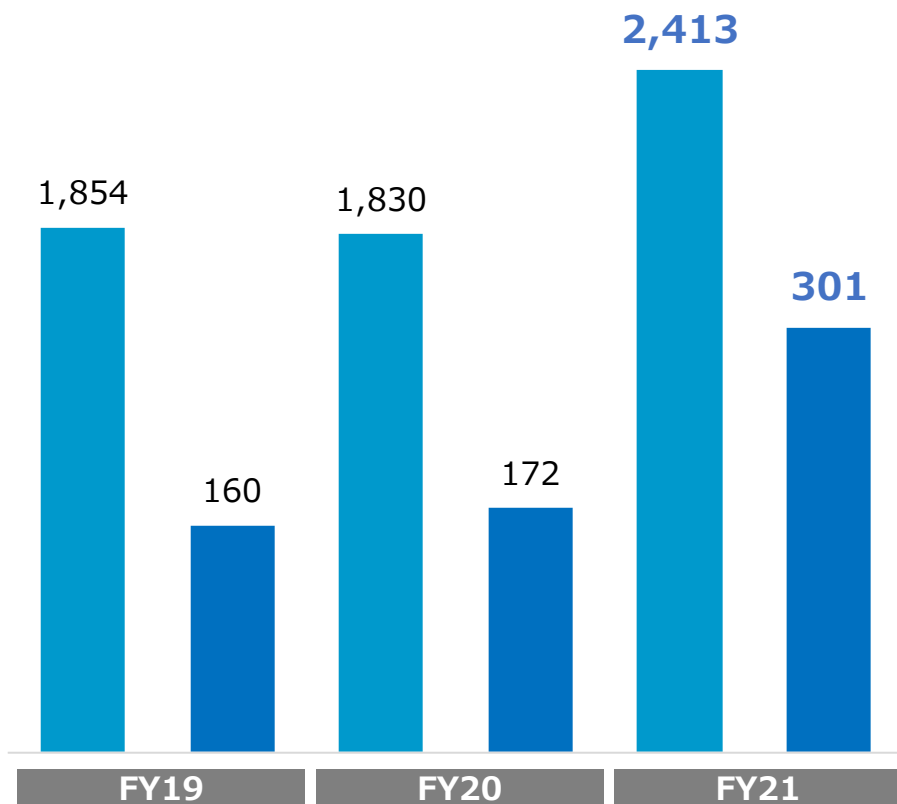
※21/8上方修正（受注高は22/2上方修正）

## 2. 売上・営業利益・利益率の推移（年度）

- 売上高：半導体・電子の投資活発化等により、前年同期比**32%増加**
- 部材長納期化・価格上昇の影響はあるもののモノづくり力強化による利益率改善・売上増加等により、売上総利益率は19年度比**3.3pt改善**、上場来最高水準となる**30.6%**となった。営業利益率も19年度比**3.9pt改善**し、**12.5%**となった。

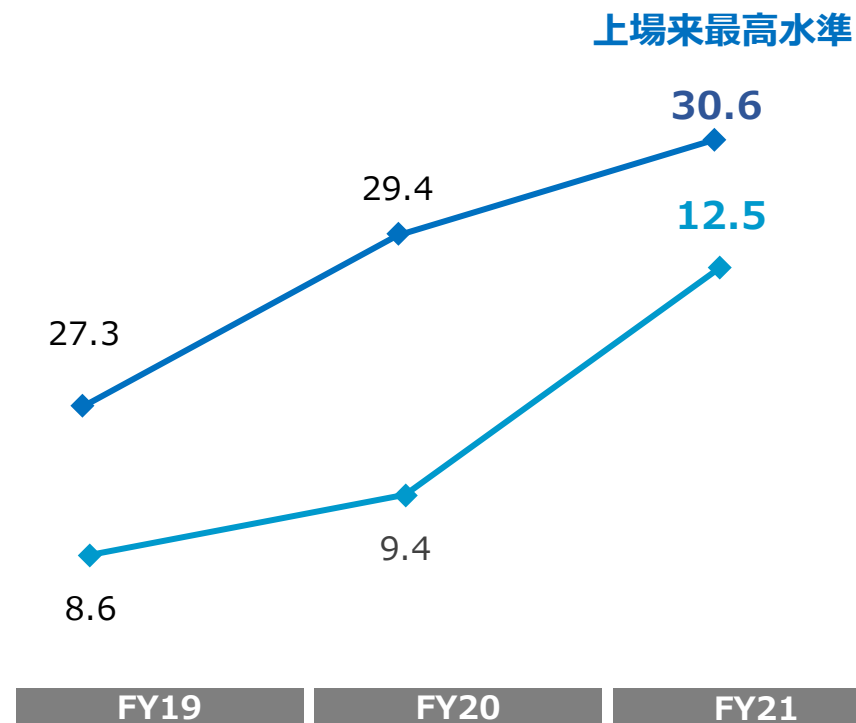
売上高・営業利益 【単位：億円】

■ 売上高 ■ 営業利益



売上総利益・営業利益率 【単位：%】

◆ 売上総利益率 ◆ 営業利益率



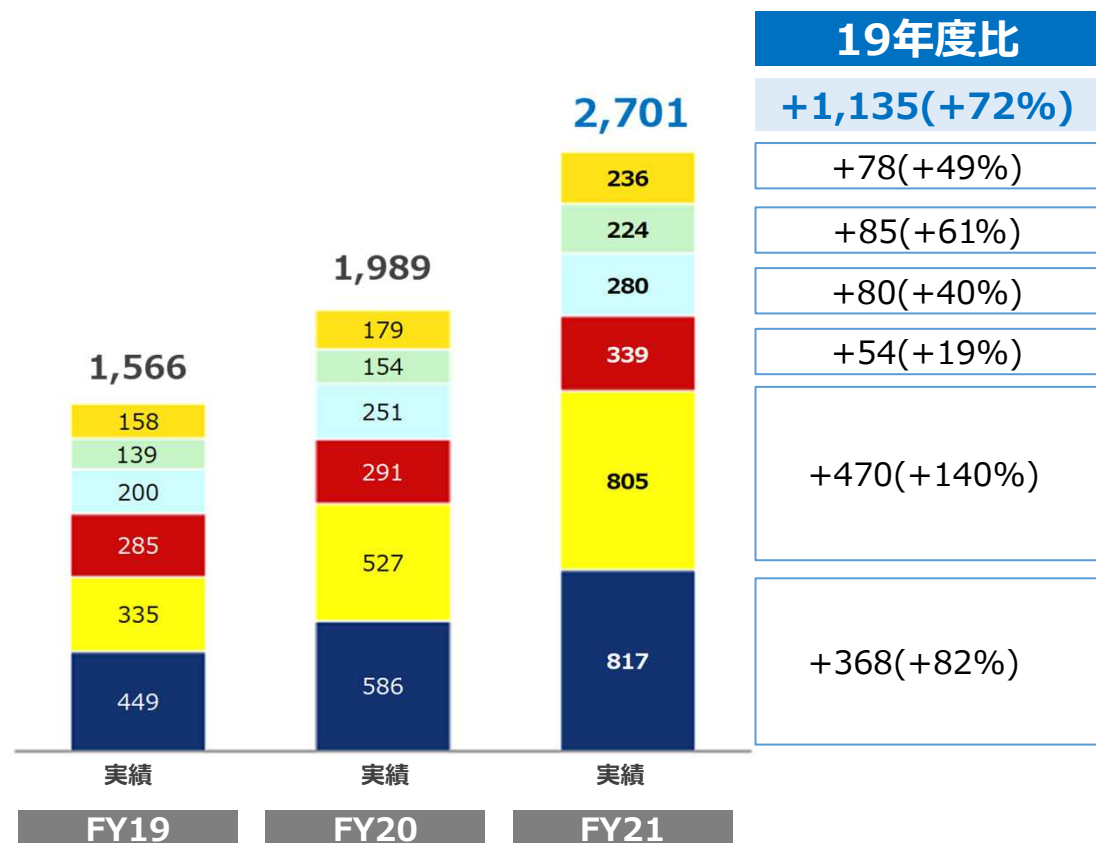


### 3. 半導体・電子・FPDの投資活発化により受注高・売上高とも大幅に増加

- 半導体・電子・FPDの投資活発化により、受注高・売上高ともに19年度比大幅に増加
- 19年度比、全品目で受注高・売上高が増加

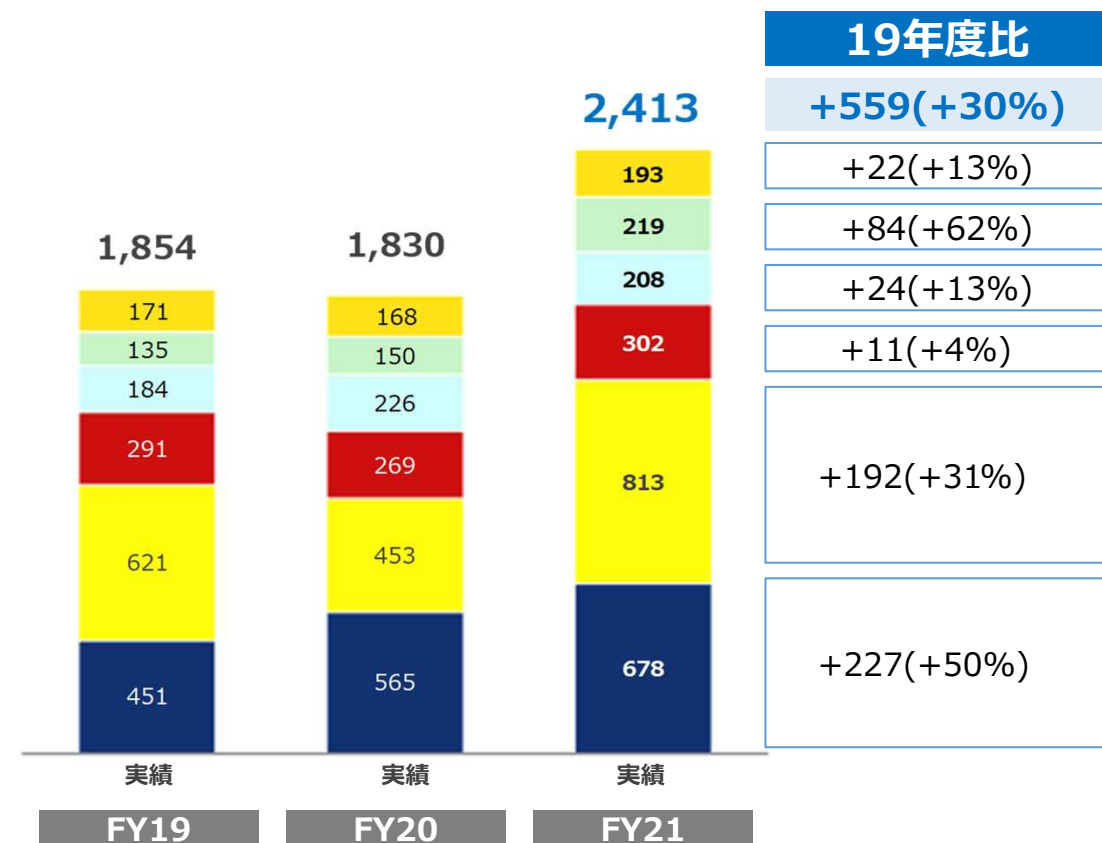
#### 受注高

【単位：億円】



#### 売上高

【単位：億円】

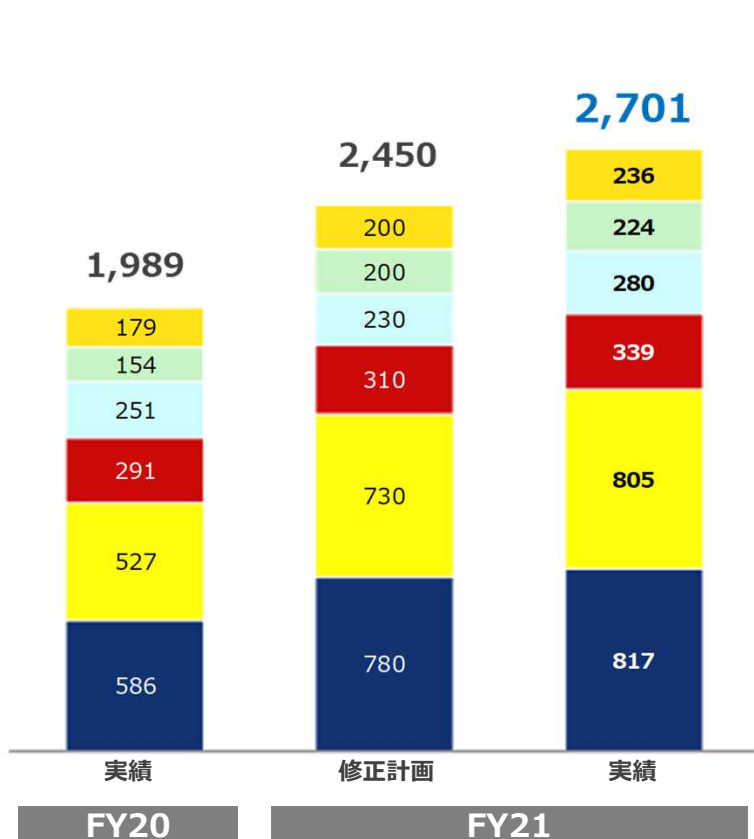


# 4. 受注高の増加要因

- 半導体・電子・FPDの投資活発化により、前年同期比+712億円、計画比+251億円ともに大幅増加
- 全品目で前年同期・計画を上回る実績

## 受注高

【単位：億円】



前年同期比	修正計画比
+712(+36%)	+251(+10%)
+57(+32%)	+36(+18%)
+70(+45%)	+24(+12%)
+29(+12%)	+50(+22%)
+48(+16%)	+29(+9%)
+278(+53%)	+75(+10%)
+231(+39%)	+37(+5%)

### 半導体・電子（前年同期比 39%増加）

- **ロジック**:メタル・ハード・マスク工程増加
- **メモリ**:投資継続
- **パワーデバイス・各種電子デバイス**:日本・中国中心に増加

### FPD（前年同期比 53%増加）

- **LCD**投資増加
- スマートフォンタブレット用**OLED**投資活発化

### コンポーネント（前年同期比 16%増加）

- 半導体・電子、EV関連用**ポンプ**・**計測器**・**電源**好調

### 材料（前年同期比 45%増加）

- 半導体・電子、FPD用**ターゲット材**好調

### その他（前年同期比 32%増加）

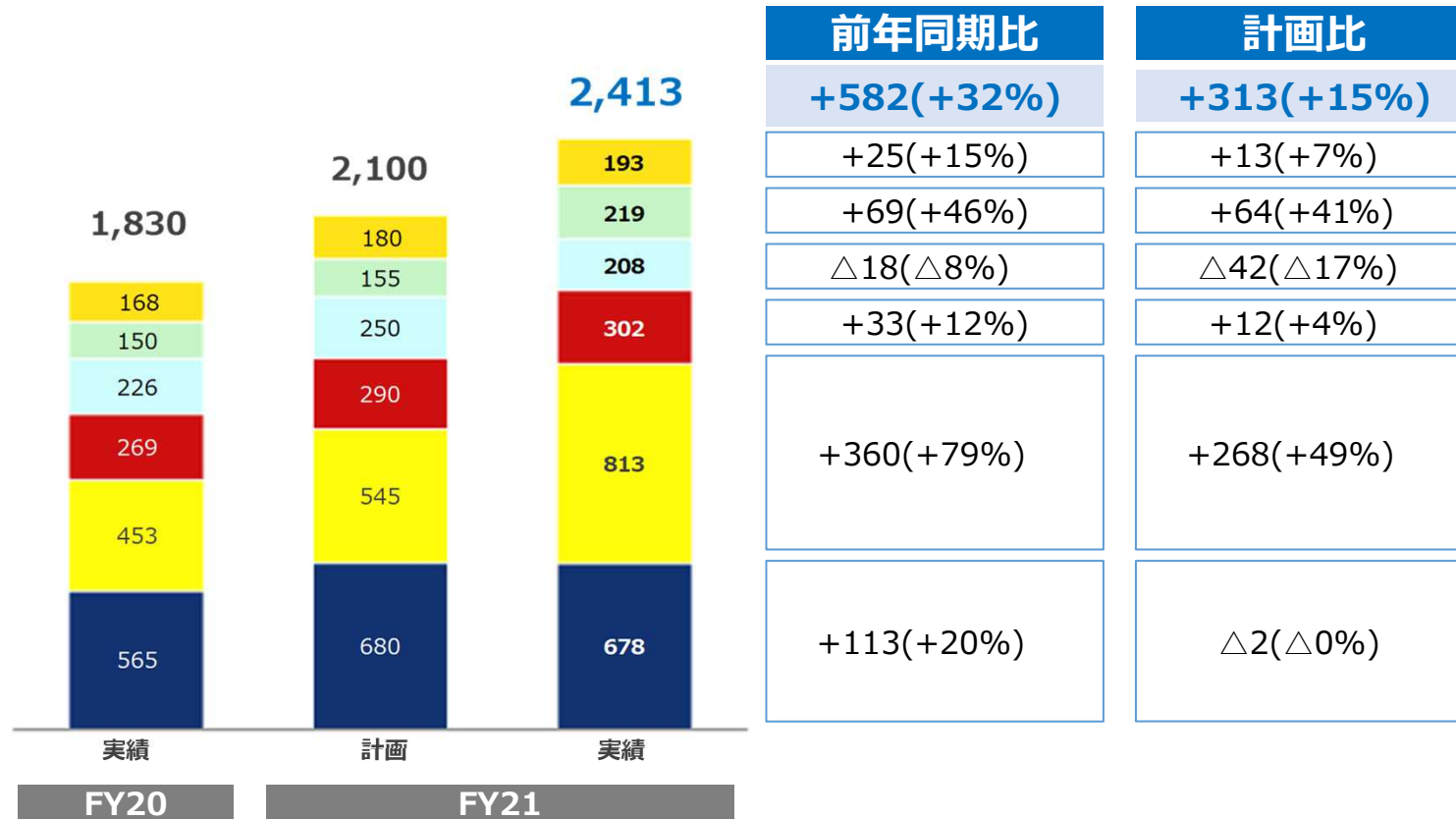
- **表面分析装置**受注拡大

# 5. 売上高の増加要因

● 半導体・電子・FPDの投資活発化により、前年同期比+582億円、計画比+313億円ともに大幅増加

## 売上高

【単位：億円】



### 半導体・電子（前年同期比 20%増加）

- 部品長納期化等の影響はあるもののロジック・メモリ・パワーデバイス・各種電子デバイス投資活発化により前年同期比を上回る

### FPD（前年同期比 79%増加）

- LCDの受注増加による売上高増加

### コンポーネント・材料・その他

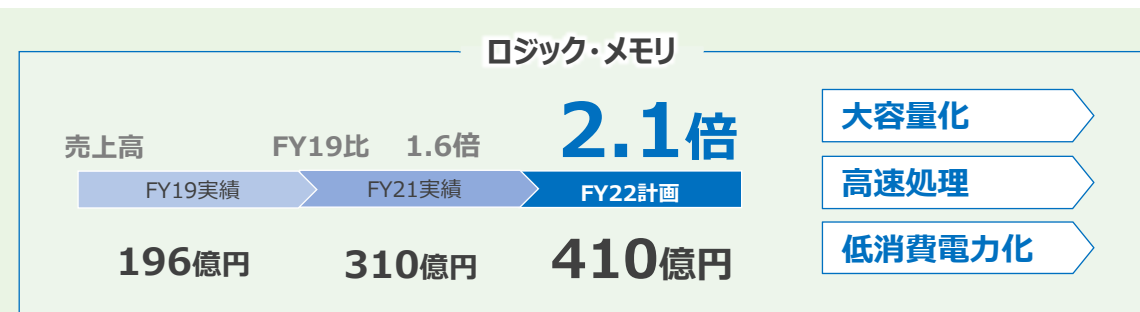
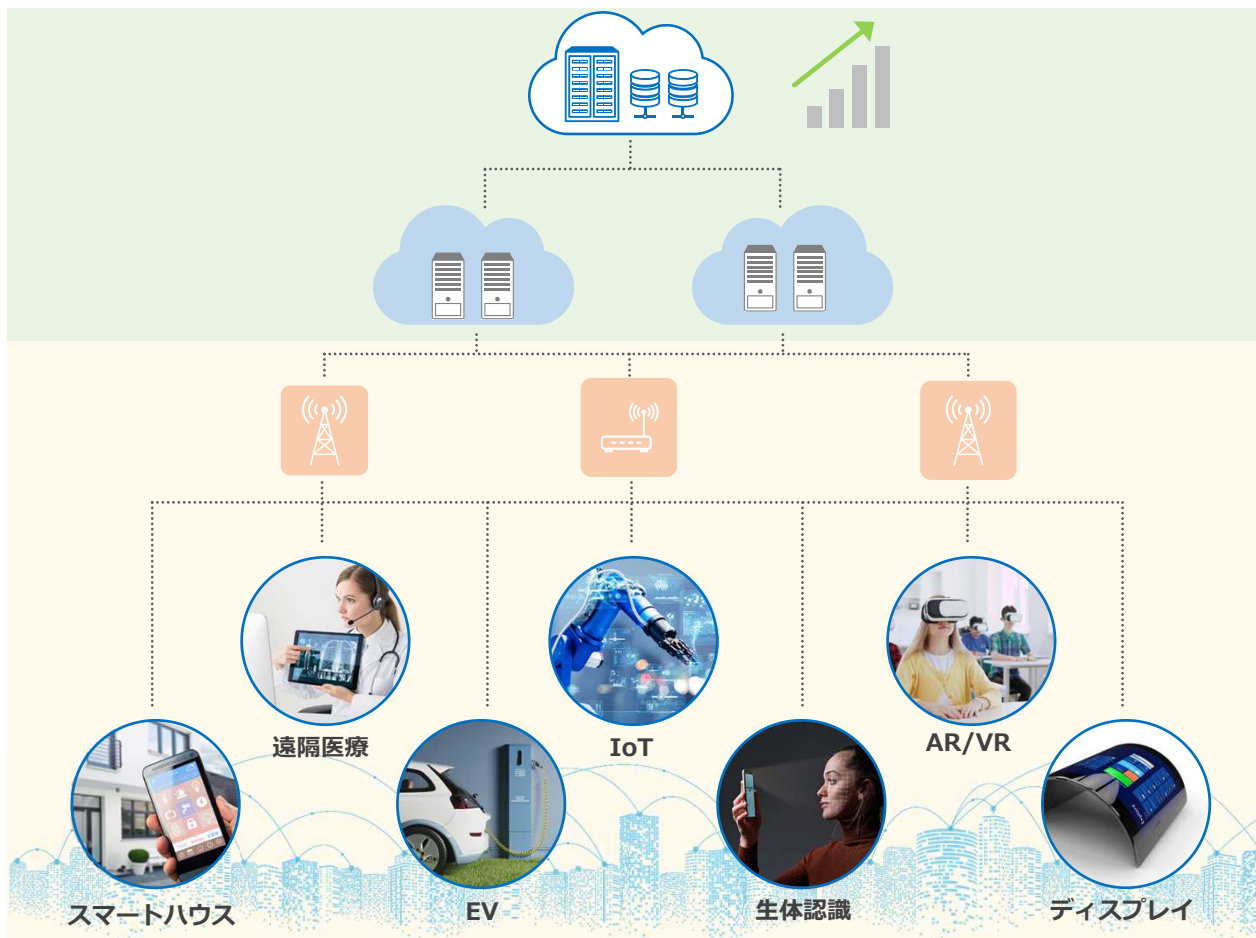
- 受注増加に伴い、前年同期比・計画比増加



# 中期経営計画進捗・ 2022年度 業績予想

# 1. 半導体・電子・FPD : 中長期的に投資拡大継続

- 「スマート社会化・デジタル化+メタバース」×「グリーンエネルギー化」  
半導体・各種電子デバイス・ディスプレイ : 「技術革新投資」×「増産投資」
- 各国支援による地域サプライチェーン構築のための投資も活発化

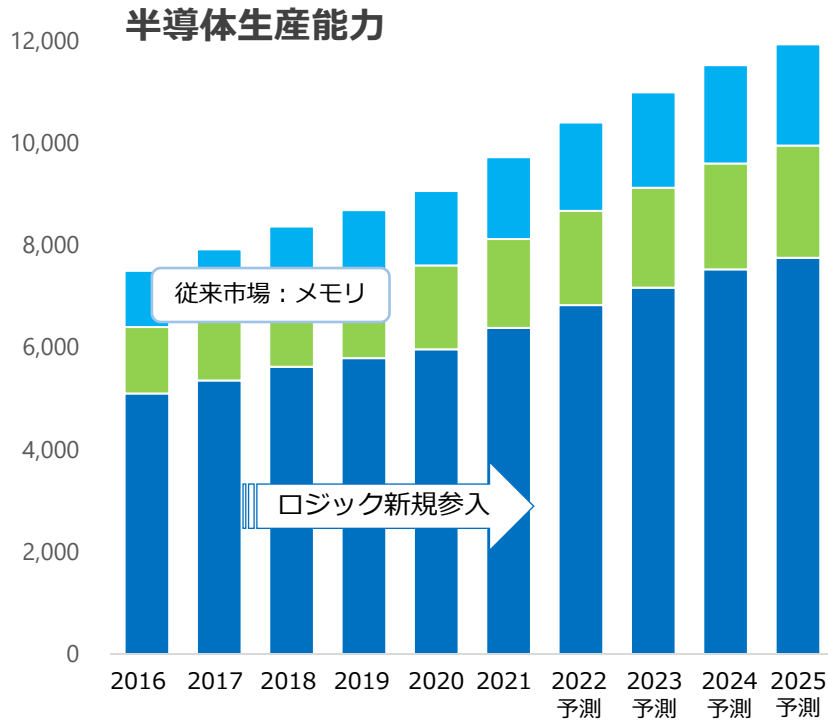


## 2-(1) 半導体：MHM工程⇒他工程参入で成長

- ロジック：EUV導入で必要となるメタル・ハード・マスク（MHM）工程参入実現(18年)  
⇒5ナノ以下のデファクトスタンダード採用により市場の伸びを上回る成長実現
- セカンドベンダーとして他工程参入の機会増加⇒ビジネスチャンス拡大
- ロジックとメモリの両輪で成長実現

### ロジック参入でビジネスチャンス拡大

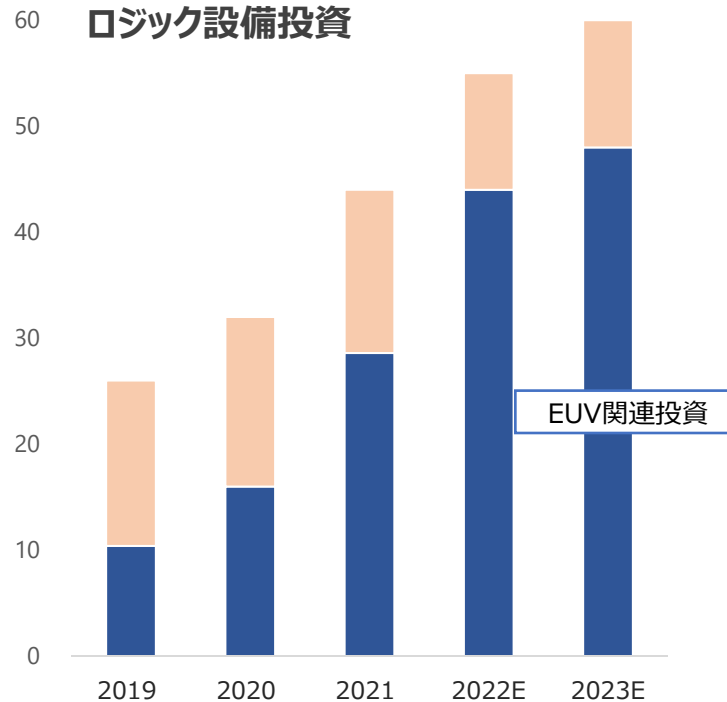
■ Logic ■ NAND ■ DRAM 【k/month】



出所：SEMI等をもとに当社予測

### EUV関連投資拡大：8割

■ EUV関連投資 ■ 汎用ロジック投資 【単位：bnUS\$】



出所：SEMI,各社投資計画等をもとに当社予測

### MHM・他工程参入

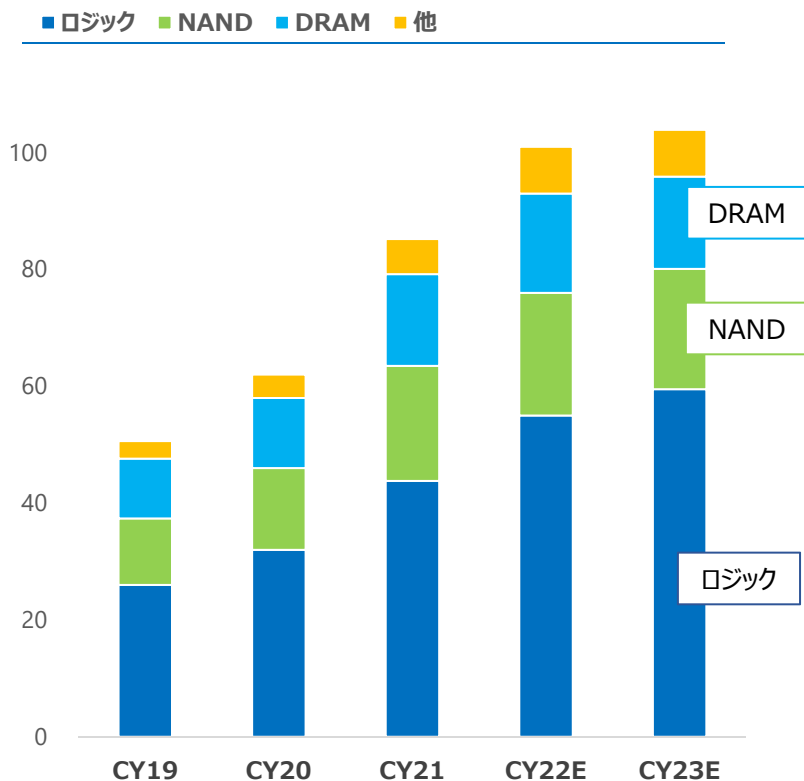
- ファウンドリー2社の5ナノ以下の工程でデファクトスタンダード採用
- ロジック分野はEUV関連投資が約8割を占め、MHM装置需要増加
- ロジック・ファウンドリーメーカーの最先端EUV関連投資は引き続き拡大方針
- セカンドベンダーとしての他工程参入・他社でのMHM工程採用により更なる成長を目指す

## 2-(2) 半導体：市場を上回る成長を実現

- ロジック：MHM工程・他工程参入・顧客拡大により、22年度は市場(19年比2.1倍)を上回る成長(3.9倍)を計画
- メモリ：従来工程・他工程参入により高水準継続

### 半導体設備投資予測

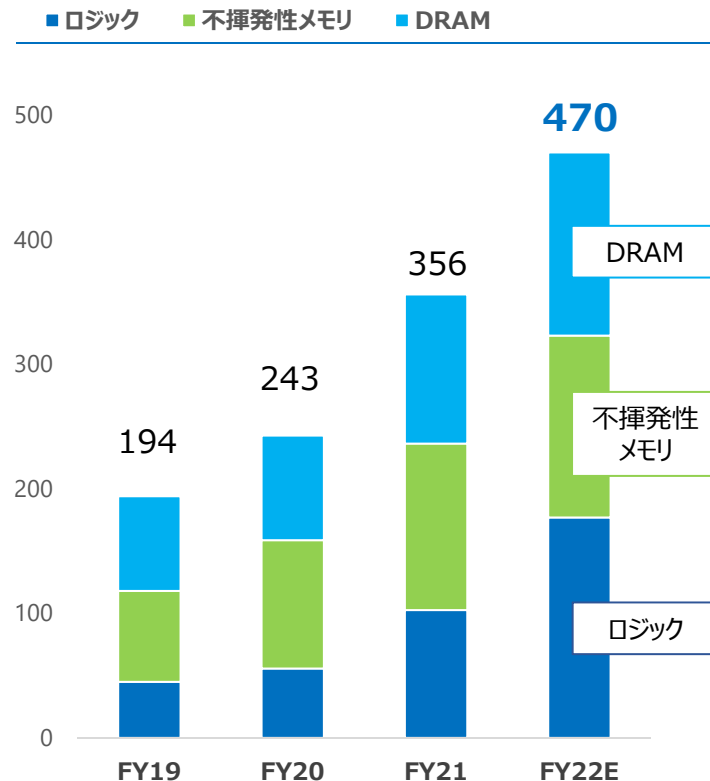
【単位：bnUS\$】



出所：SEMI

### 受注計画

【単位：億円】



### 受注動向（前年同期比32%増加計画）

#### ロジック

- MHM工程投資活発化に伴い、21年度は市場(19年比1.7倍)を上回る成長(2.3倍)を実現
- MHM工程高評価・セカンドベンダー期待により他工程参入実現⇒22年度より受注貢献
- 他社でのMHM工程採用も目指す

#### メモリ

- メモリ投資に頭打ち感がみられる中、セカンドベンダー期待もあり他工程参入で受注増加

# 3-(1) 電子：各種電子デバイス分野の投資拡大継続

	主なデバイス	最終用途	投資動向
<p><b>パワーデバイス</b></p>	IGBT SiC Si-MOSFET	<ul style="list-style-type: none"> <li>EV車載デバイス</li> <li>インバータモータ</li> <li>産業用ロボット</li> <li>省電力機器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ グリーンエネルギー化・EV化進展による投資活発化</li> <li>✓ <b>日系主要各社による中長期的な積極投資計画</b></li> <li>✓ <b>中国投資拡大</b>（国産化方針・地方政府支援）</li> </ul>
<p><b>オプトデバイス</b></p>	μOLED 反射防止膜 バンドパスフィルター	<ul style="list-style-type: none"> <li>AR/VR</li> <li>車載用インパネ</li> <li>3Dセンサー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 日本・中国で<b>μOLED投資活発化</b>（メタバース・リモート活用拡大等）</li> <li>✓ 3Dセンサー高度化に伴う高品質バンドパスフィルター・光回折格子需要拡大</li> </ul>
<p><b>通信デバイス</b></p>	SAW・BAWフィルター RFデバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>スマートフォン</li> <li>無線基地局</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 5G拡大等に伴うSAW・BAWフィルターの技術革新・増産投資継続</li> <li>✓ 5Gインフラ整備に伴う投資継続</li> </ul>
<p><b>電子部品 (MEMS)</b></p>	Piezo-MEMS 各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>指紋認証</li> <li>LiDAR</li> <li>電源デバイス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 車載向けセンサー・MEMSマイクロフォンなど量産に向けた<b>Piezo-MEMS投資活発化</b></li> <li>✓ 日本・中国で各種電子デバイス技術革新に伴う投資活発化</li> </ul>
<p><b>実装</b></p>	FanOut WLP・PLP Info-package	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC</li> <li>スマートフォン</li> <li>データサーバ</li> <li>IoTデバイス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ エンタープライズ・コンシューマCPU向け実装の投資活発化</li> </ul>

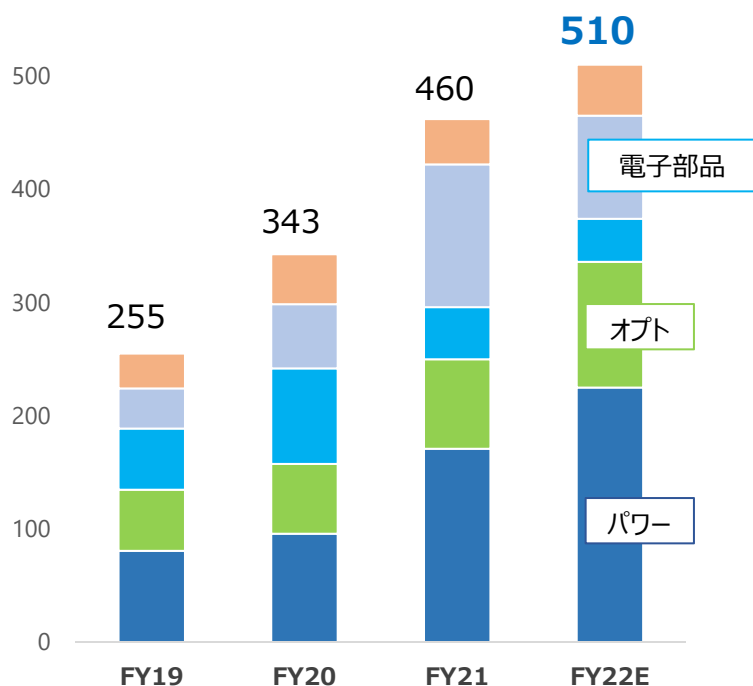


# 3-(2) 電子：パワーデバイス、日本・中国中心に成長

- パワーデバイス、オプトデバイス等の投資が日本・中国を中心に活発化
- 特に中国は政府の国産化方針もあり、パワーデバイス、各種電子デバイス投資活発化

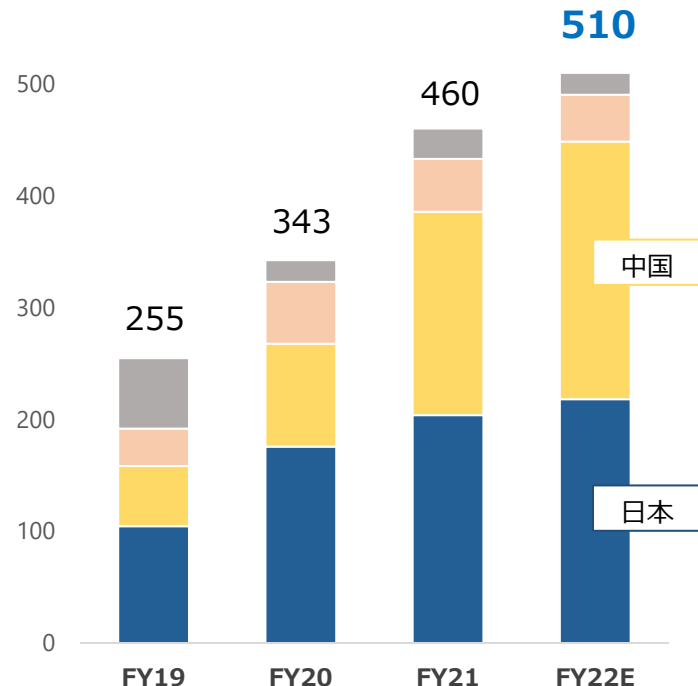
受注計画（分野別） 【単位：億円】

- パワーデバイス
- オプトデバイス
- 通信デバイス
- 電子部品 (MEMS)
- 実装



受注計画（地域別） 【単位：億円】

- 日本
- 中国
- 台湾
- その他



## 投資・受注動向（前年同期比11%増加計画）

### パワーデバイス

日本：8inch生産能力増強に加えて、12inch化・SiC化投資開始

中国：SiCの増産投資に加え、12inchIGBT投資開始

### 電子デバイス

#### （オプトデバイス）

日本：AR/VR用μOLED向け、車載用デバイス投資活発化

#### （電子部品）

日本：アナログIC・ダイオード・コンデンサ・チップ抵抗などの各種電子デバイスの増産投資

中国：Piezo-MEMS投資活発化

#### （実装）

台湾：大手ファウンドリーによる高付加価値エンタープライズCPU向けの投資継続

# 3-(3) パワーデバイスは高成長継続

## ● グリーンエネルギー化・EV化進展等に伴いパワーデバイスの高成長継続（22年度受注：19年度比2.8倍）

	IGBT	SiC	Si-MOSFET
市場環境	<p><b>日本</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8inch増産投資 + 12inch投資開始</li> </ul> <p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国産化方針・地方政府支援</li> <li>12inch設備投資開始</li> </ul>	<p><b>日本</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8inch投資開始</li> </ul> <p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国産化方針・地方政府支援</li> <li>6inch増産投資拡大</li> </ul>	<p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国産化方針・地方政府支援</li> <li>家電製品等のインバーター化</li> <li>Low～Midエンド機器の需要旺盛</li> </ul>
アルバックの強み	<p><b>日本</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>裏面電極用スパッタ装置で高いシェア</li> <li>日系主要各社との豊富な実績</li> </ul>	<p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SiC用イオン注入装置シェア7割</li> <li>エンジニア派遣常駐による技術営業力</li> </ul>	<p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現地生産による価格競争力</li> <li>現地設計によるカスタマイズ対応</li> <li>サプライチェーン体制構築</li> </ul>
成長戦略	<p><b>日本</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8inchスパッタ装置シェア堅持</li> <li>12inchスパッタ装置展開</li> </ul> <p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12inchイオン注入装置展開</li> </ul>	<p><b>日本</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8inchスパッタ装置展開</li> </ul> <p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6inchイオン注入装置拡販</li> <li>6inchスパッタ装置展開</li> </ul>	<p><b>中国</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蒸着装置 高水準堅持</li> </ul>

## 電子デバイス需要増加・輸入依存脱却

- ・パワーデバイス
- ・各種電子デバイス



## 中国国産化方針

- ・サプライチェーンの安定化
- ・貿易収支改善

地方政府支援（各種優遇・支援）

## 中国国内投資加速化（景気対策）

### 新エネルギーシフト（グリーン化）

- ・再生可能エネルギーシフト
- ・新エネルギー車回復・増加
- ・LiB生産量増加

### デジタルインフラ建設

- ・5G基地局
- ・データセンター

## 沿海部中心にパワー・電子デバイス工場建設増



# 4-(1) FPD : OLED化・EVバッテリー用巻取蒸着装置が牽引

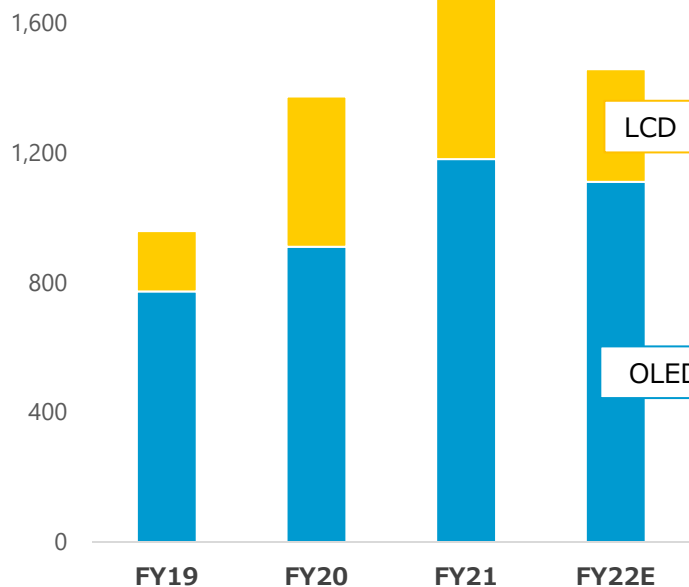
- ITパネル（タブレット・PC・車載用・医療用・ゲーム用等）投資活発化：LCD⇒OLED化進展
- 大型基板OLED投資の量産開発進展⇒22~23年度量産投資本格化
- 今年度よりバッテリー用巻取蒸着装置が寄与

## FPD設備投資動向

【単位：億円】

(蒸着・スパッタ)

■ OLED ■ LCD

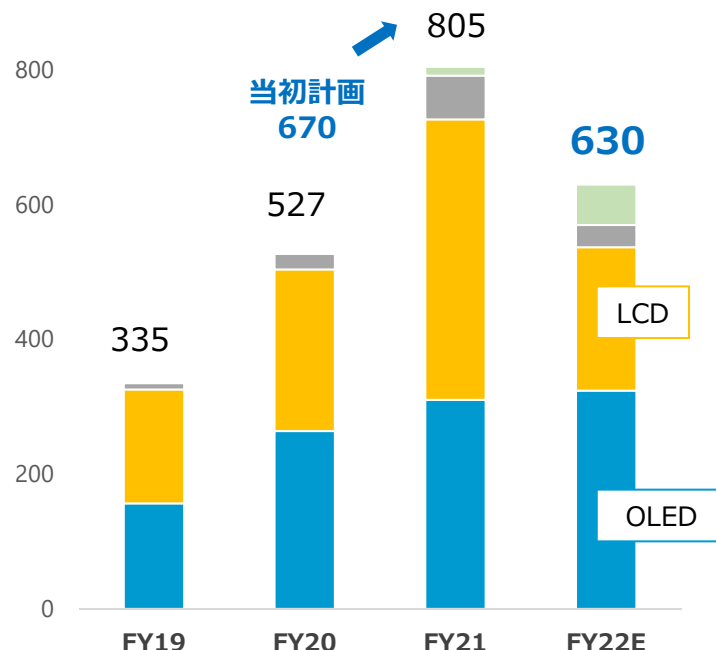


出所：当社予測

## 受注計画

【単位：億円】

■ OLED ■ LCD ■ キャパシタ・その他 ■ バッテリー



## 投資動向

- 21年度上期はITパネルを中心としたLCDパネル投資が集中
- 大型基板OLED投資の量産開発進捗するも22年度は一時的な端境期
- 23年度以降、OLED投資がパネル投資を本格牽引
- EVバッテリーの小型大容量化・安全性向上に向けた巻取式蒸着装置が今年度より貢献⇒23年度以降拡大

## 受注動向

- 21年度のLCD投資の反動により、22年度のFPD受注は減少
- 23年度以降は大型基板OLEDのスパッタリング装置・バッテリー用巻取蒸着装置中心に受注回復 (700~800億円程度の受注を見込む)

## 4-(2) FPD : 大型基板OLED用スパッタ装置

- ITパネル用8.5世代OLEDの量産投資本格化(22~23年度) : スパッタ装置も8.5世代対応
- ITパネルは高精細化ニーズが高く、従来の縦型スパッタ装置に加え、より低パーティクル化が期待できる枚葉型G8.5スパッタ装置を開発 ⇒両方式対応可能

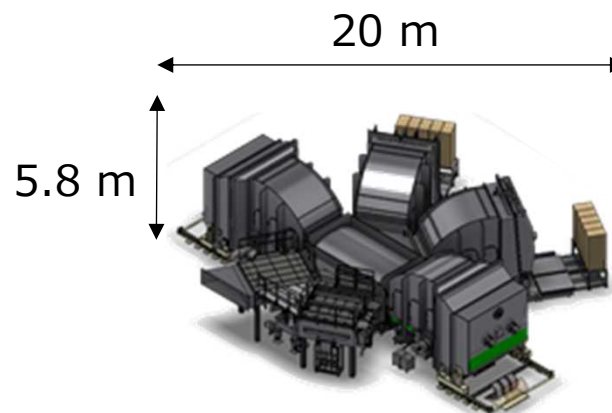
### G8.5OLEDシフト

高精細化  
Higher Definition

生産性向上  
Productivity Improvement

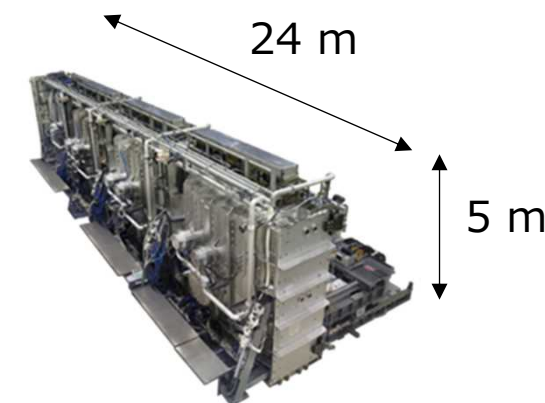
大画面化  
Larger-sized

枚葉型スパッタリング装置 (G8.5)



ラインアップ

縦型スパッタリング装置(G8.5)



特長

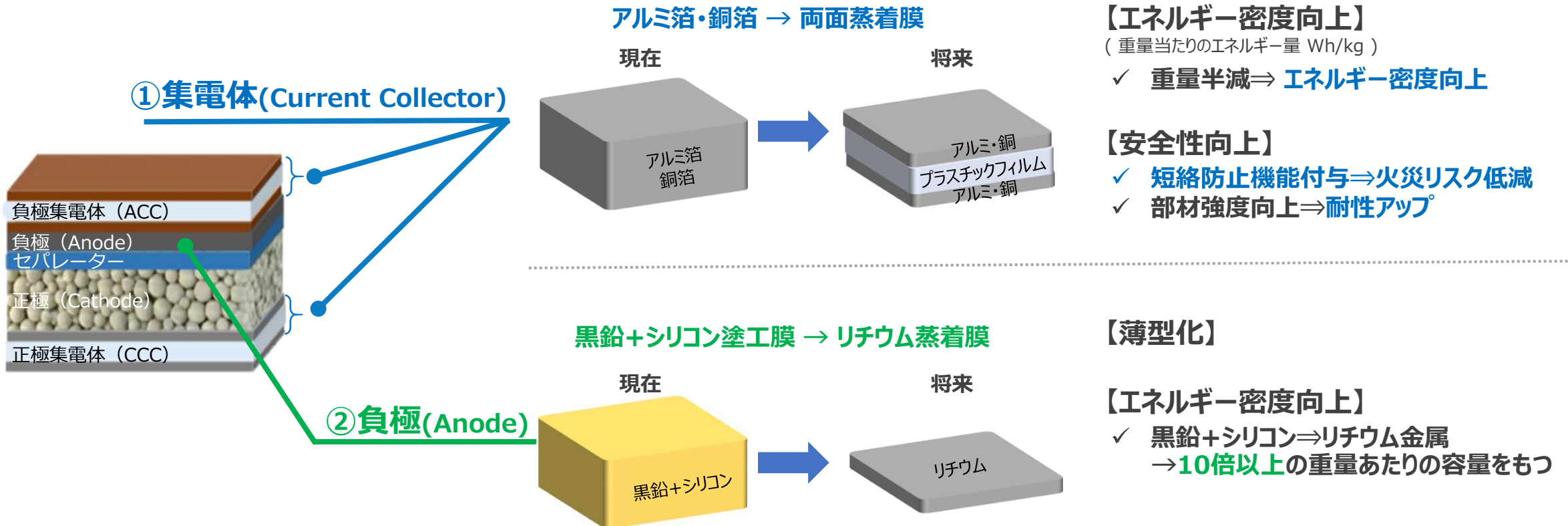
- ✓ 枚葉型スパッタ装置 (G6)の大型化で、低パーティクル化・高精細化を実現
- ✓ カソードの大型化・搬送ノウハウを活かし低パーティクル化対応 (大型スパッタ装置の実績・ノウハウ・強みを活用)

- ✓ G10.5スパッタ装置(シェア9割)の大型パネル搬送技術を活かして、ITパネル用に更にパーティクル抑制

# 4-(3) FPD : バッテリービジネス

## ● EVバッテリーの小型大容量化、安全性向上実現のため、巻取蒸着装置を開発

- ①集電体：安全性・軽量化実現のため、金属箔の両面蒸着フィルムへの置き換え投資開始(22年度)
  - ②負極：大容量化実現のため、従来の「黒鉛+シリコン」⇒「リチウム蒸着膜」：開発中
- ⇒NEDOグリーンイノベーション基金事業「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」採択



## コンポーネント

### 半導体電子・EV関連 投資活発化



- 半導体電子製造装置用ポンプ・DC/RF電源需要堅調
- EV用リチウムイオン電池・燃料電池向けリークディテクター増加
- OLED・半導体電子用クライオポンプ堅調



スクルー型ドライ真空ポンプ  
LSシリーズ

リークディテクター

## マテリアル

### 半導体向け 受注拡大



- 先端半導体向け高品質焼結ターゲット (W・WSi等) 増加
- 半導体装置と連動した粉末焼結ターゲット (Ti等)  
→半導体ビジネスを成長の柱に
- LCD・OLEDの高精細化・低消費電力化を実現するIGZOが増加



半導体向け  
W スパッタリングターゲット



半導体向け  
Ti スパッタリングターゲット

## カスタマーサポート

### 装置稼働率上昇 受注拡大

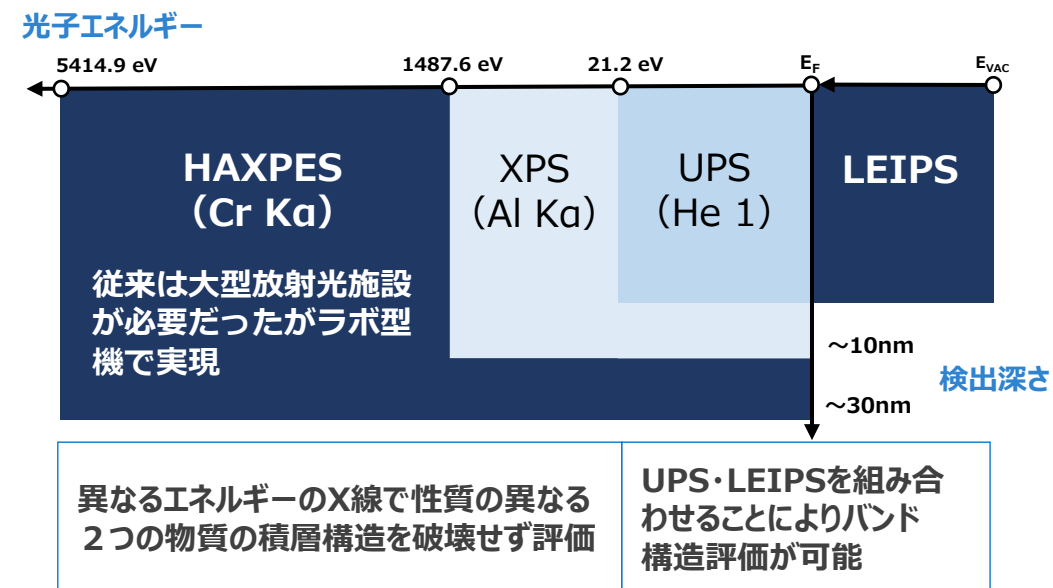


- 半導体電子の投資活発化・装置稼働率上昇に伴い、受注増加
- 日本、中国、韓国、台湾で部品販売・CIPビジネス拡大



# 6. アルバック・ファイ：X線光電子分光分析装置の新モデルでシェアアップ

- 21年：新モデル（VersaProbe4）発売⇒世界シェアアップ（3割台→5割弱）
- 22年7月：多機能新モデル発売
  - ・ 従来4機種（異なる測定機能）⇒1台に集約
  - ・ 電池・自動車関連部品の組成分析、半導体の薄膜評価等に1台で対応可能（HAXPES（Cr）・LEIPS機能を持つ分析装置はアルバック・ファイのみ）
 ⇒拡大する需要に対応しシェアアップ

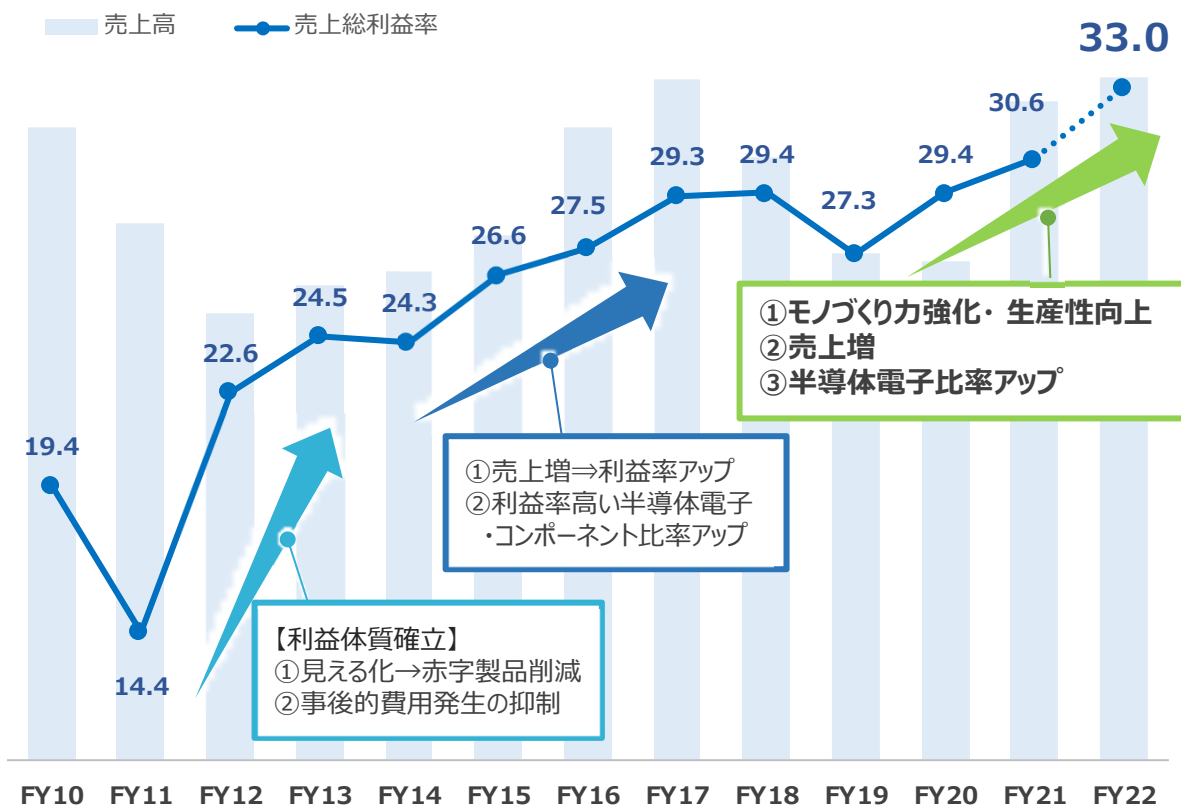




# 7-(1) モノづくり力強化による利益率改善を推進

- 部材長納期化・価格上昇の影響はあるものの、モノづくり力強化により、売上総利益率は着実に改善
- 本社の「開発・設計」と国内生産子会社の「製造」一体化（吸収合併）により海外工場も含めたモノづくり力強化⇒利益率改善を強力に推進

売上総利益率推移 【単位：％】

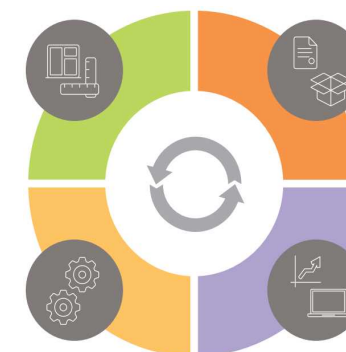


## 技術設計の改革

技術図面の完成度向上  
設計バリューエンジニアリング強化

## 購買の改革

購買体制一体化  
グローバル・サプライチェーン



## 生産工程の改革

生産拠点の専門化  
製造生産性向上

## 情報システム基盤強化

業務プロセス標準化  
生産性向上・経営管理の高度化

## モノづくり力強化を加速化

- ✓ 本社の「開発・設計」と国内生産子会社2社（東北・九州）の「製造」の一体化により海外工場も含めたモノづくり力強化



## 安定調達・生産に貢献

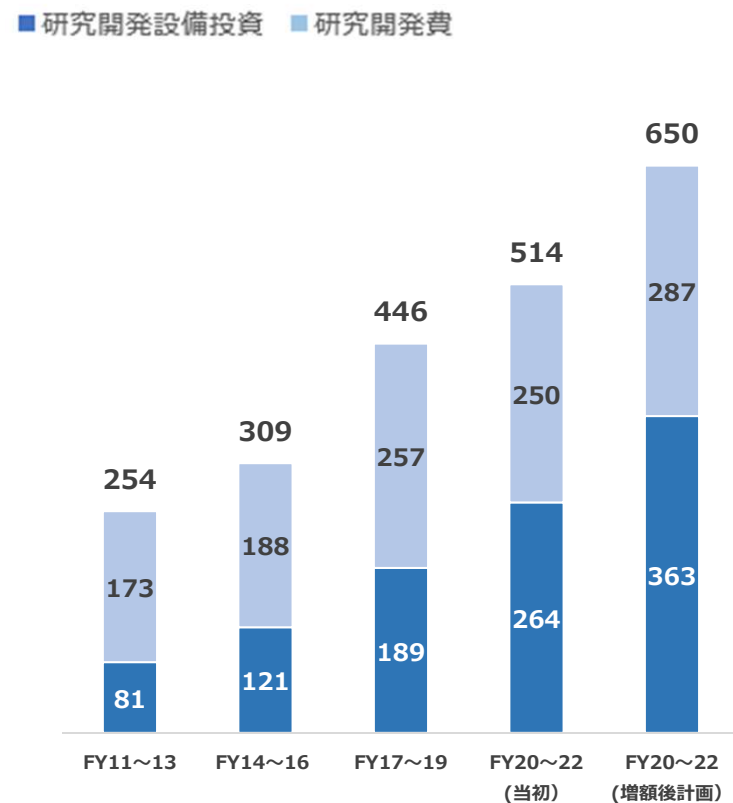
- ✓ 地域ごとに構築したグローバルサプライチェーンの一体化・連携



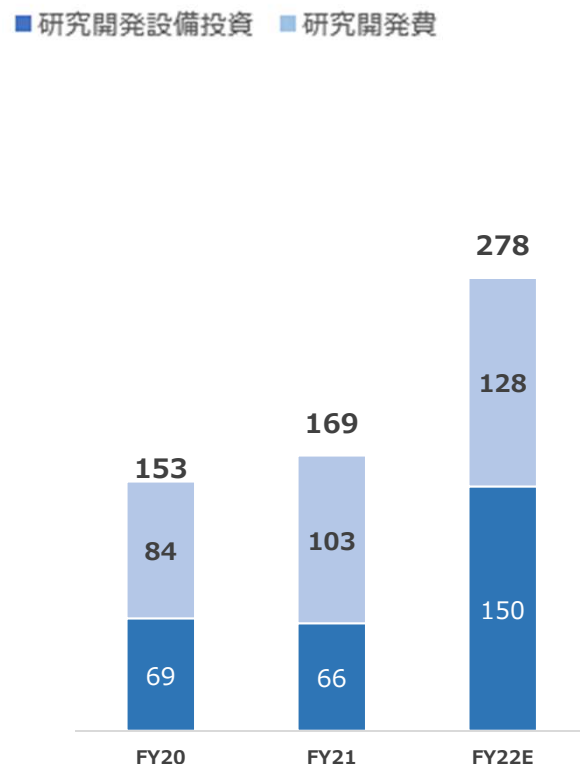
## 8. 研究開発投資の進捗

- 21年度は部材長納期化の影響もあり、研究開発投資の一部が22年度にズレ込むが、引き続き成長分野の研究開発投資継続・拡大 ⇒次期中期経営計画でも成長のための研究開発投資は増額方針
- 半導体はMHM・他工程、電子はパワー・各種デバイス、標準化・モジュール化、FPDはOLED用G8.5スパッタ・バッテリー用巻取蒸着などの開発を推進 ⇒今後の成長の柱

研究開発投資推移（3年合計）【単位：億円】



研究開発投資推移（単年度）【単位：億円】



### 半導体：4割弱

MHM・他工程(ロジック・メモリ)

### 電子：2割弱

パワーデバイス（イオン注入・スパッタ）  
各種電子デバイス（標準化・モジュール化）

### FPD：3割弱

大型基板スパッタ（G8.5バックプレーン）  
バッテリー用巻取蒸着装置

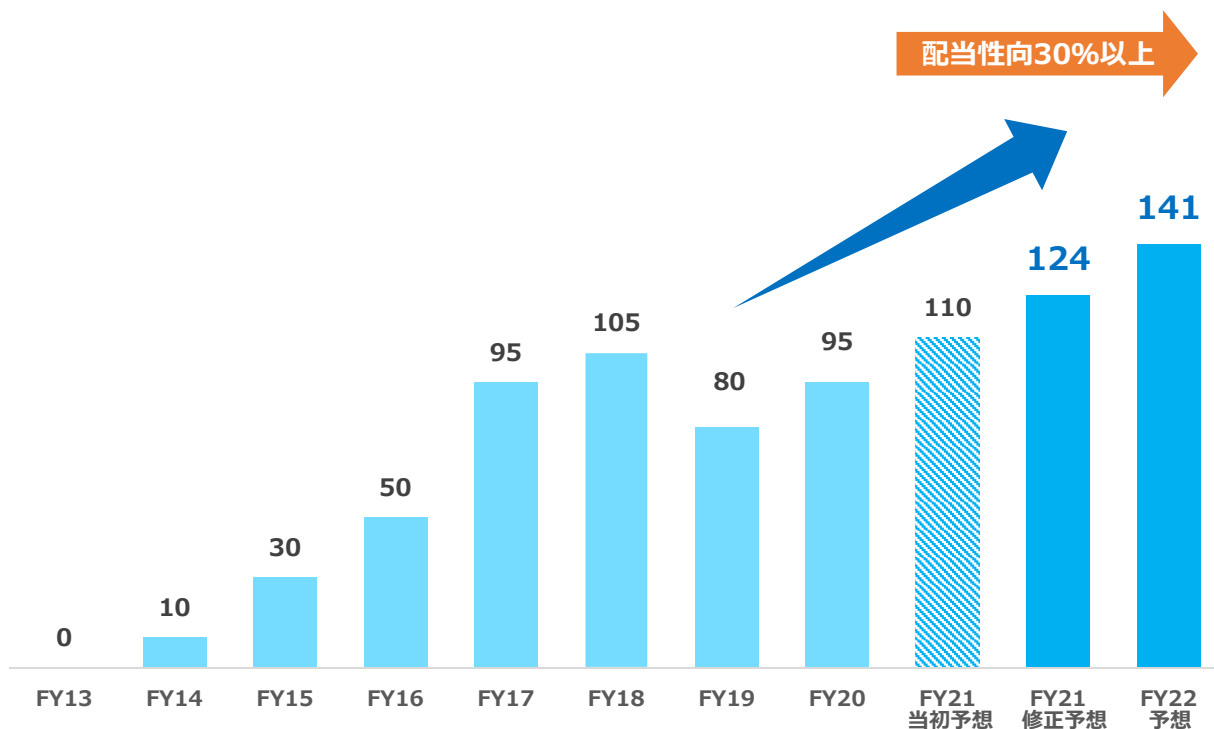
### コンポーネント：1割弱

# 9. 株主還元

- 株主還元は最重要政策の一つ。更なる成長により、増配による株主還元を目指す  
(着実に配当を増額、21年度より配当性向30%以上を目標に)
- 顧客の設備投資動向の変動・技術革新の激しい業界  
⇒成長領域への研究開発投資力確保を最重視。業界変動への対応や業績変動リスクへ対応のため財務基盤も拡充

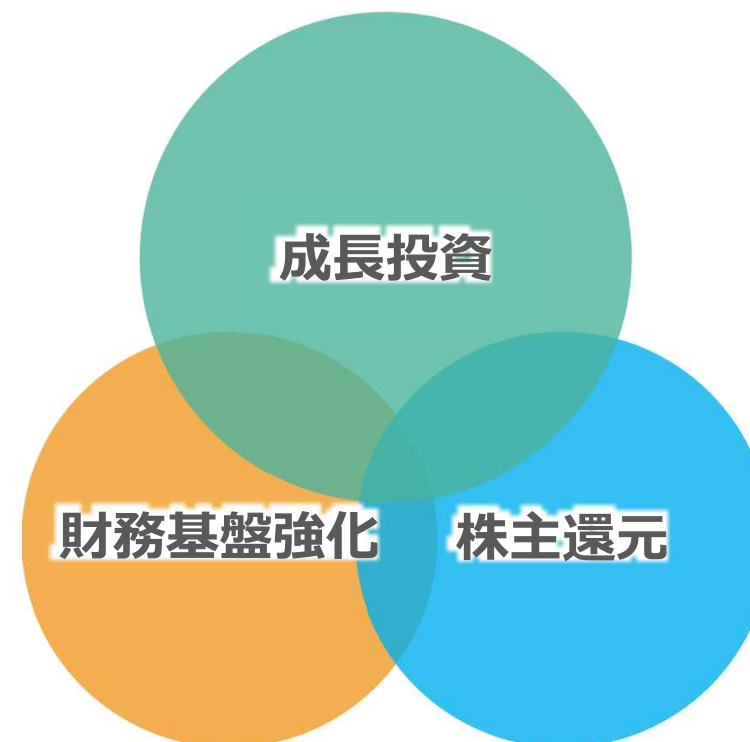
## 1株当たり配当金・配当性向推移

【単位：円】



【単位：%】

年度	配当性向 (%)
FY13	-
FY14	5.8
FY15	8.9
FY16	10.1
FY17	13.0
FY18	27.7
FY19	36.6
FY20	31.5
FY21 当初予想	30.1
FY21 修正予想	30.2
FY22 予想	30.2



## 基本方針

- 成長に向けた開発投資（選択と集中）
- 体質転換による利益重視の経営

## 重点戦略

- 成長事業の強化
- 研究開発力強化
- モノづくり力強化
- グループ経営効率強化

	目標値	FY2020 (実績)	FY2021 (実績)	FY2022 (計画)
売上高	2,350 億円	1,830 億円	2,413 億円	2,500 億円
売上総利益率	35%以上	29.4%	30.6%	33.0%
営業利益率	16%以上	9.4%	12.5%	13.8%
ROE	13%以上	9.2%	11.4%	12.0%
営業CF	290 億円	255 億円	339 億円	240 億円

# 11. 中期経営計画の取り組みの進捗

	中期経営計画の取り組み（計画）		成果・進捗評価	
成長事業の強化 研究開発力強化	半導体	ロジックの微細化工程新規参入 メモリ投資再開・新工程参入	ロジック・メモリ投資堅調⇒売上計画超過 MHM工程+他工程参入+顧客拡大で成長	
	電子	モジュール化による提案装置拡大 中国での開発・営業・サポート体制強化	パワー・オプト・電子デバイス等の投資活発化 ⇒日本・中国を中心に売上計画超過 モジュール化「uGmniシリーズ」で提案装置拡大 中国営業・技術サポート体制強化で売上計画超過	
	FPD	大型基板OLED量産開発 利益体質に転換	LCD投資継続・OLED化で売上計画超過 着実にモノづくり力強化実施→利益率改善	
モノづくり力強化	技術設計・調達・生産一体改革 ⇒生産性向上⇒利益率改善		部材長納期化等により最終年度目標利益率未達も 各種施策を着実に実施→利益率は着実に改善	
グループ経営効率強化	ビジネスユニット経営推進 自社製品を持つグループ会社の経営強化		韓国グループ会社統合 国内製造子会社2社の吸収合併 各社にて経営改革を推進	
経営基盤強化	人財育成・活性化		新人事制度導入 教育センター設立	
	情報システム基盤強化		生産性向上に向けた各種システム整備を着実に実施	
	財務基盤強化		ROE 11.4% 営業CF 339億 (自己資本比率：53.3%)	

# 12. 業績予想におけるリスクの前提と対応

## 【2022年度業績予想の前提】

- 想定される下記のリスクを織り込んで業績予想を作成
- 今後、急激な環境変化発生時には、速やかに対応策検討・必要に応じた計画見直し等を行う方針

市場が想定するリスク	現状と影響	前提・対応
<b>部材長納期化・価格高騰</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ リードタイム長期化・売上貢献に遅れ</li> <li>・ モノづくり力強化・利益率改善の遅れ</li> </ul>	<p><b>前提</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 部材長納期・価格高騰は当面継続</li> </ul> <p><b>対応</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生産子会社合併で海外工場も含めたモノづくり力強化</li> <li>・ 顧客・サプライヤー連携⇒先行受注・手配、代替部品検討</li> <li>・ 製造コスト・原価低減の徹底、販売価格の適正化</li> </ul>
<b>半導体・電子関連投資頭打ち</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 顧客の投資計画を確認し計画策定</li> </ul>	<p><b>前提</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最先端ロジック・パワーデバイスは投資拡大見込み</li> <li>・ メモリ・電子デバイスも工程拡大・新規顧客で拡大</li> <li>・ 中国の国産化対応で拡大</li> </ul> <p><b>対応</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 技術革新投資対応・工程拡大</li> </ul>
<b>LCD投資減 大型基板OLED量産投資遅延</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前期：LCD投資集中</li> <li>・ 大型基板OLEDの量産投資に向け各社量産開発中</li> </ul>	<p><b>前提</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LCD投資減少・大型基板OLED量産投資は22~23年度</li> </ul> <p><b>対応</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大型基板OLEDのバックプレーン用スパッタ装置開発推進</li> <li>・ EVバッテリー用巻取蒸着装置開発・量産対応早期化</li> </ul>
<b>地政学リスク</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ウクライナ情勢の影響は軽微</li> <li>・ 中国ロックダウンの影響も軽微</li> </ul>	<p><b>前提</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地政学リスクは引き続き注視</li> </ul> <p><b>対応</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域サプライチェーン構築のための投資に対応</li> </ul>

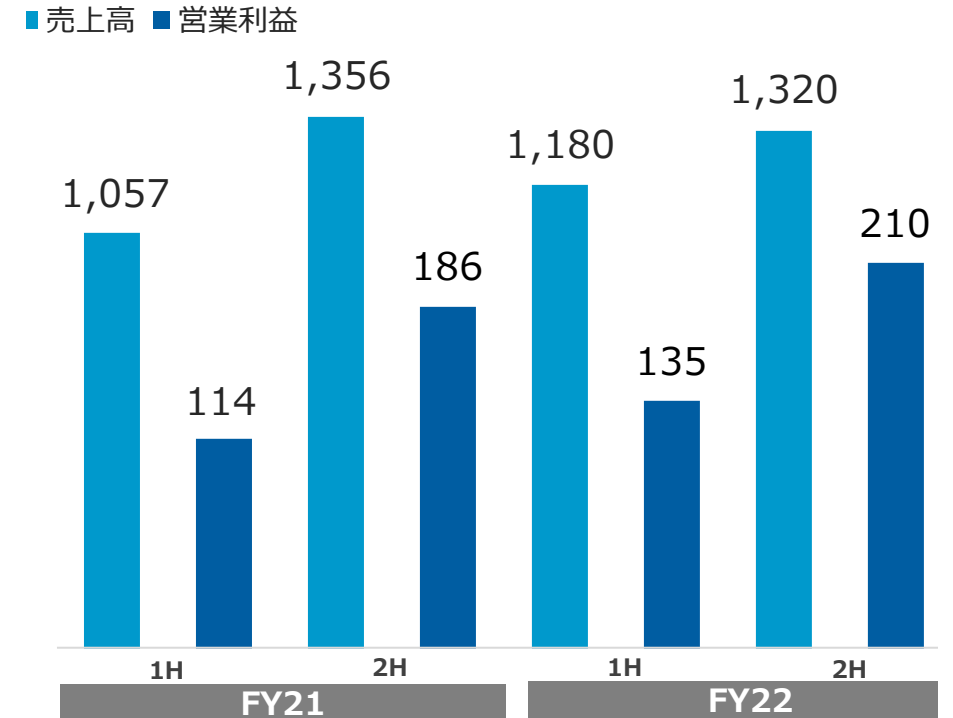
# 13. 2022年度 業績予想

- 受注高：半導体・電子投資活発化等により、前年同様の高水準を計画
- 売上高：2,500億円、前年同期比4%増加、営業利益：345億円、前年同期比15%増加の計画
- 営業利益率：13.8%（前年同期比+1.3pt）に改善計画

【単位：億円】	2021年度	2022年度計画			
	実績	上期	通期	前年同期比	
受注高	2,701	1,320	2,700	-1	0%
売上高	2,413	1,180	2,500	87	4%
営業利益	301	135	345	44	15%
率	12.5%	11.4%	13.8%	1.3pt	-
経常利益	322	140	355	33	10%
率	13.3%	11.9%	14.2%	0.9pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	92	230	28	14%
率	8.4%	7.8%	9.2%	0.8pt	-

## 売上高と営業利益の推移

【単位：億円】





# 14. 受注高・売上高計画

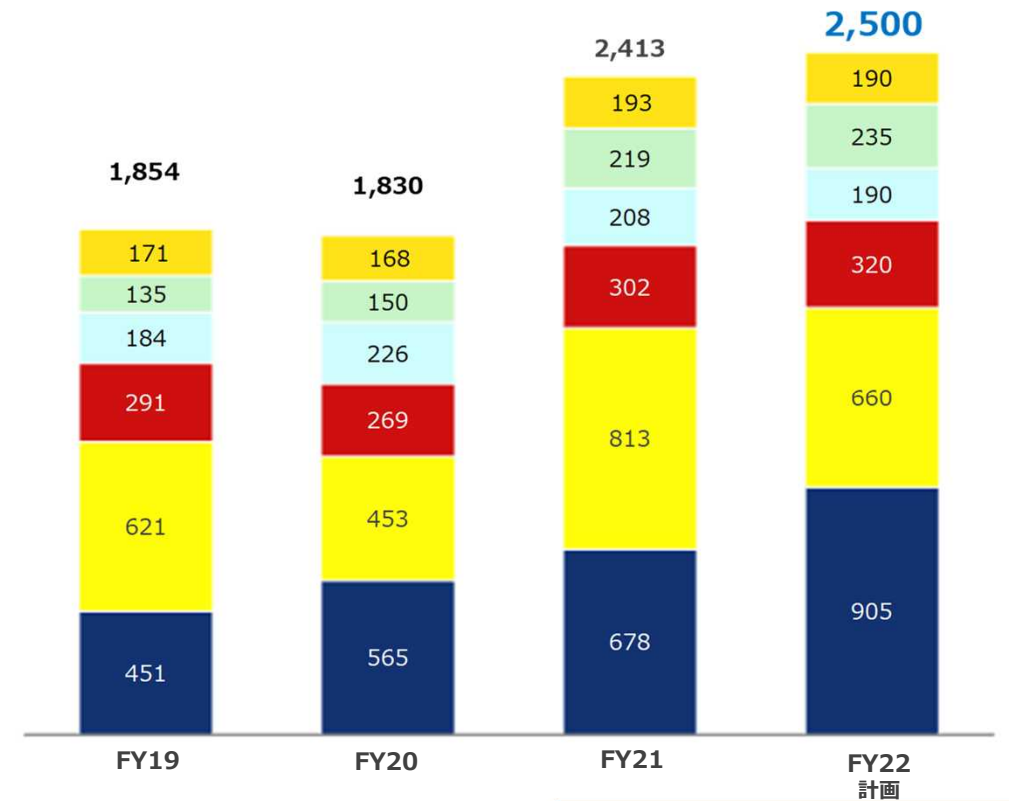
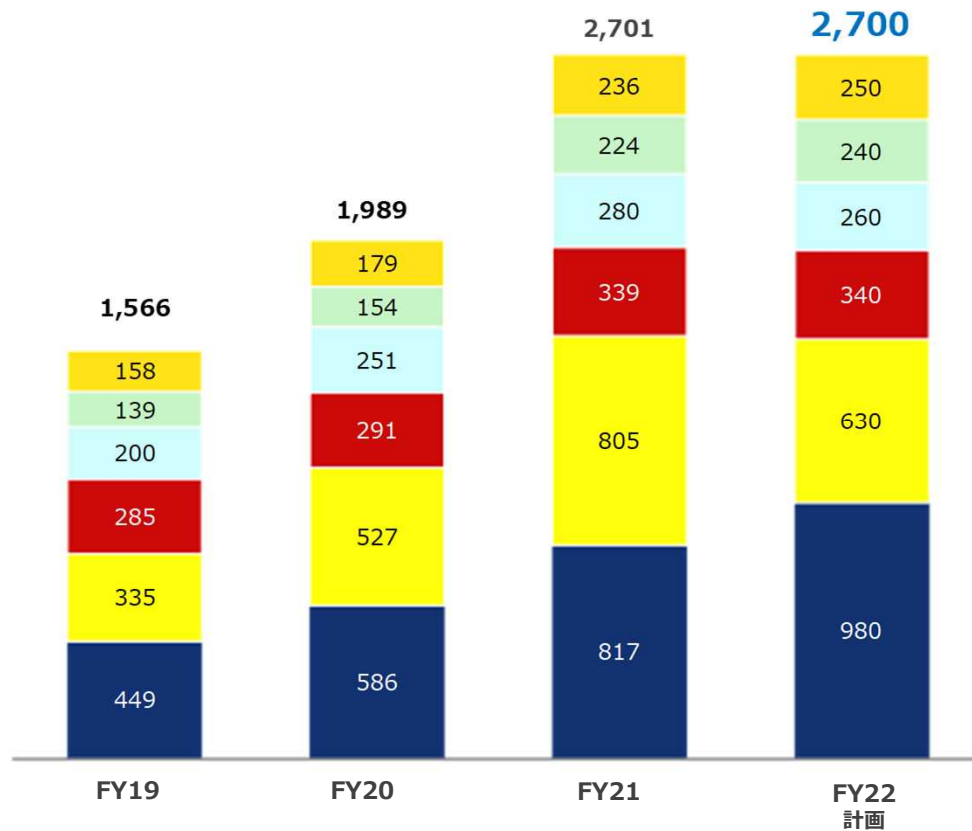
- 受注高：21年度に急増したITパネル用LCD投資の反動でFPDが減少するものの、半導体・電子が増加し、同水準の計画
- 売上高：FPDが一時的に減少するものの、半導体電子を中心に増加し、4%増加の計画

**受注高** 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- FPD製造装置
- コンポーネント
- 一般産業用装置
- 材料
- その他

**売上高** 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- FPD製造装置
- コンポーネント
- 一般産業用装置
- 材料
- その他



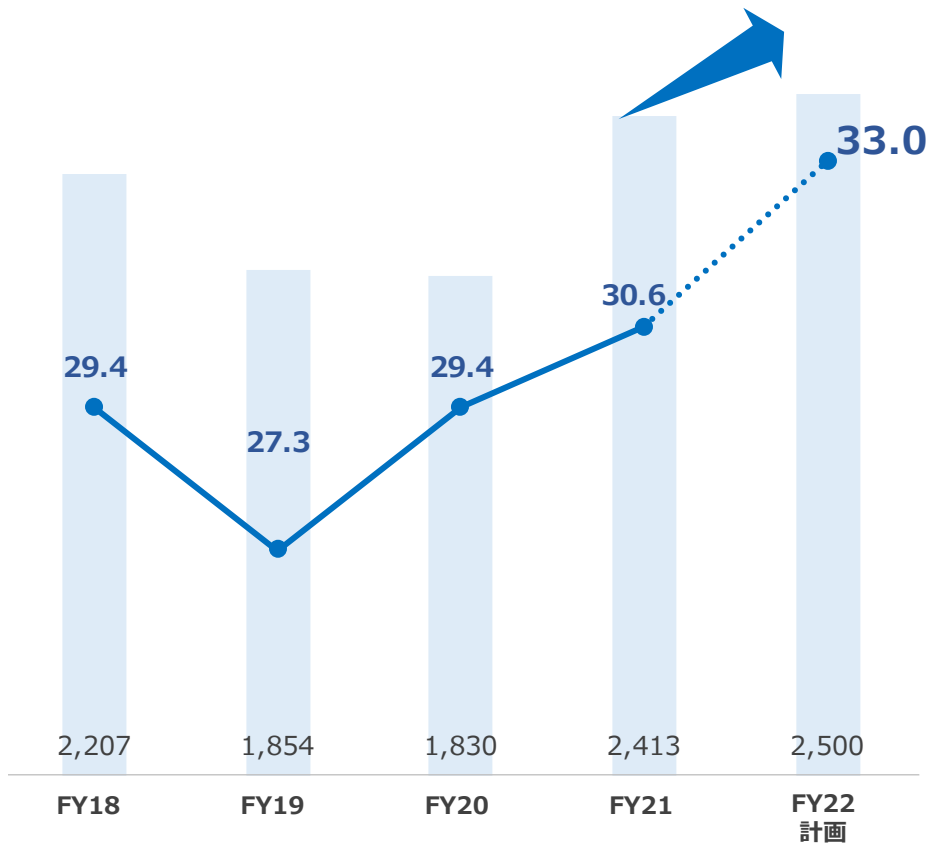
# 15. モノづくり力強化等により利益率改善を推進

- 部材長納期化・価格上昇の影響はあるものの、モノづくり力強化・生産性向上、売上増加等により、売上総利益率・営業利益率の改善を推進

## 売上総利益率

【単位：億円、%】

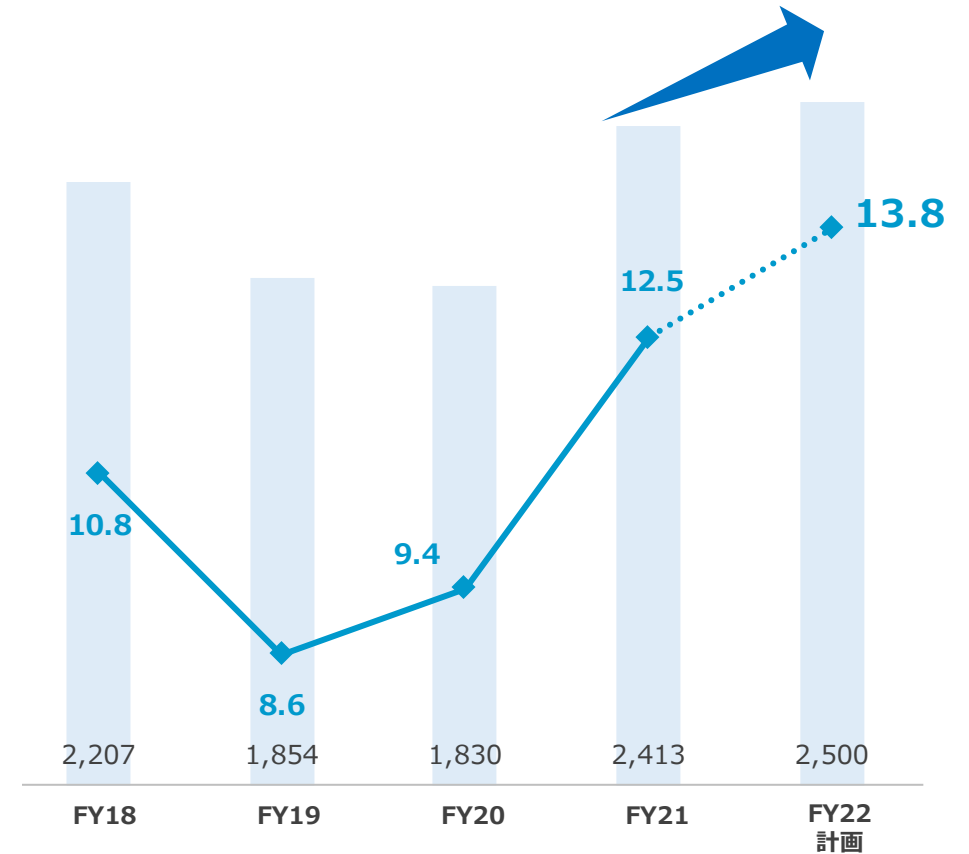
売上高 売上総利益率



## 営業利益率

【単位：億円、%】

売上高 営業利益率



次期中期経営計画を策定し、23年8月に公表予定

以下の成長分野に開発投資を集中し、増収増益・利益率向上を図る方針

### 半導体・電子

- 先端ロジックMHM工程に加え、配線工程等他工程参入・他社採用で成長
- メモリ投資に頭打ち感が見られる中、セカンドベンダー期待もあり他工程参入で成長
- 日中のパワーデバイス・各種電子デバイスの技術革新投資への対応・モジュール型装置投入で成長
- 中国の国産化対応で成長

### FPD

- 大型基板OLEDのスパッタ装置・バッテリー用巻取り蒸着装置で成長

## 気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) 提言への賛同

気候変動関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) による提言へ賛同し、「TCFDコンソーシアム」に参加しています。TCFDの提言に基づき、気候変動が事業に与えるリスク・機会の両面に関して、戦略・リスク管理・ガバナンスなどの観点から情報開示を進めていきます。



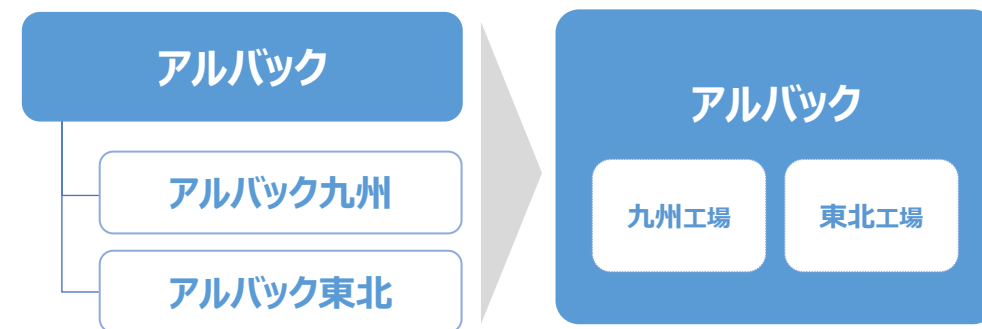
## ULVAC人権方針を策定

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、「ULVAC人権方針」を策定しました。

グローバルに事業を展開する企業として、本方針に基づき、事業活動における人権尊重の在り方について共通の認識をより明確に持ち、今まで以上に人権を尊重した事業活動を進めてまいります。

## 完全子会社の吸収合併

7月1日に国内主要製造子会社2社を吸収合併しました。「モノづくり力強化」加速のため、多種多様な製品生産技術を取り込み、生産性と利益率のより一層の向上を目指します。



スマート社会・  
デジタル社会実現



グリーンエネルギー化  
低消費電力化

社会的課題解決

メモリ	ロジック IC	センサー	通信デバイス	バッテリー
微細化		高性能化		低消費電力化

スパッタリング	真空薄膜形成技術	コンポーネント
エッチング		マテリアル
真空蒸着		CVD



# 補足資料

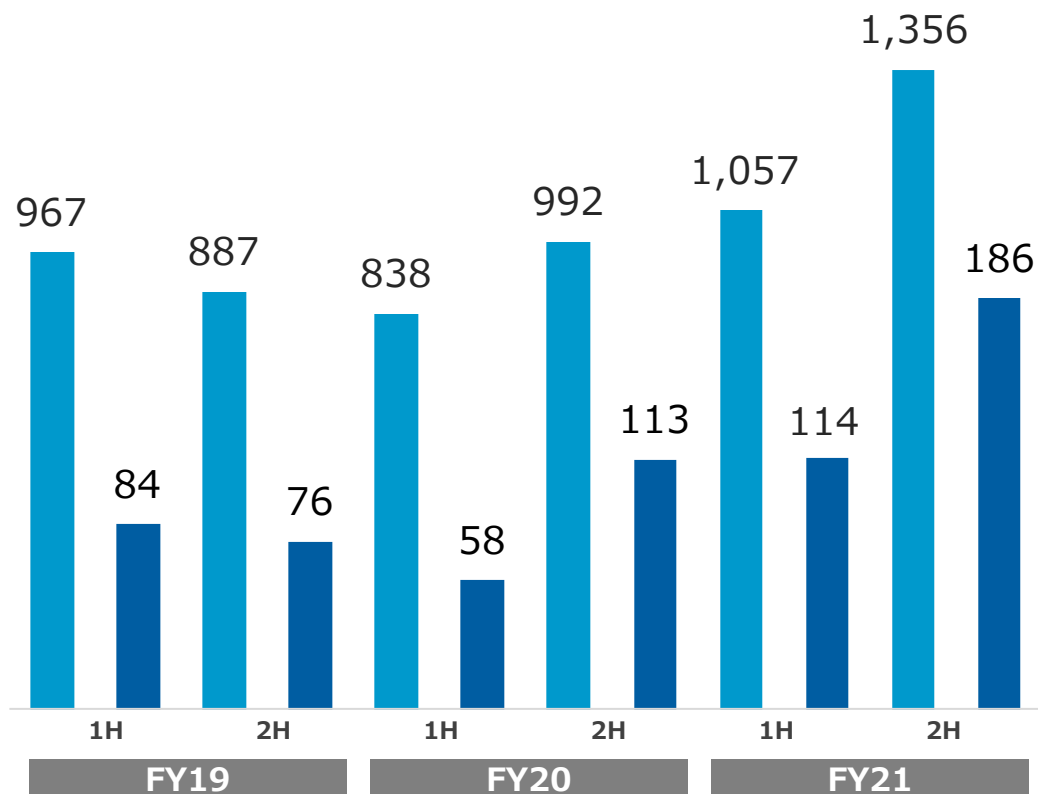
# 四半期連結業績推移

【単位：億円】	2020年度 実績							2021年度 実績							
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	通期	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	通期	前年同期比
受注高	312	598	910	421	658	1,079	1,989	663	783	1,446	596	659	1,255	2,701	+35.8%
売上高	366	473	838	447	545	992	1,830	474	583	1,057	604	752	1,356	2,413	+31.8%
売上総利益	94	139	233	134	171	304	538	132	189	321	186	230	416	737	+37.2%
率	25.7%	29.5%	27.8%	29.9%	31.4%	30.7%	29.4%	27.9%	32.4%	30.4%	30.8%	30.6%	30.7%	30.6%	+1.2pt
販管費	84	91	175	90	101	191	366	97	110	207	105	125	230	437	+19.5%
営業利益	10	49	58	43	70	113	172	36	78	114	81	105	186	301	+74.8%
率	2.7%	10.3%	7.0%	9.6%	12.9%	11.4%	9.4%	7.5%	13.5%	10.8%	13.5%	14.0%	13.8%	12.5%	+3.1pt
経常利益	10	50	60	41	78	119	180	35	85	120	84	118	202	322	+79.2%
率	2.8%	10.6%	7.2%	9.2%	14.4%	12.0%	9.8%	7.4%	14.6%	11.4%	13.9%	15.6%	14.9%	13.3%	+3.5pt
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益	3	42	45	37	66	103	148	22	59	81	56	64	121	202	+36.3%
率	0.9%	8.9%	5.4%	8.3%	12.0%	10.4%	8.1%	4.7%	10.1%	7.7%	9.3%	8.6%	8.9%	8.4%	+0.3pt

## 売上高・営業利益

【単位：億円】

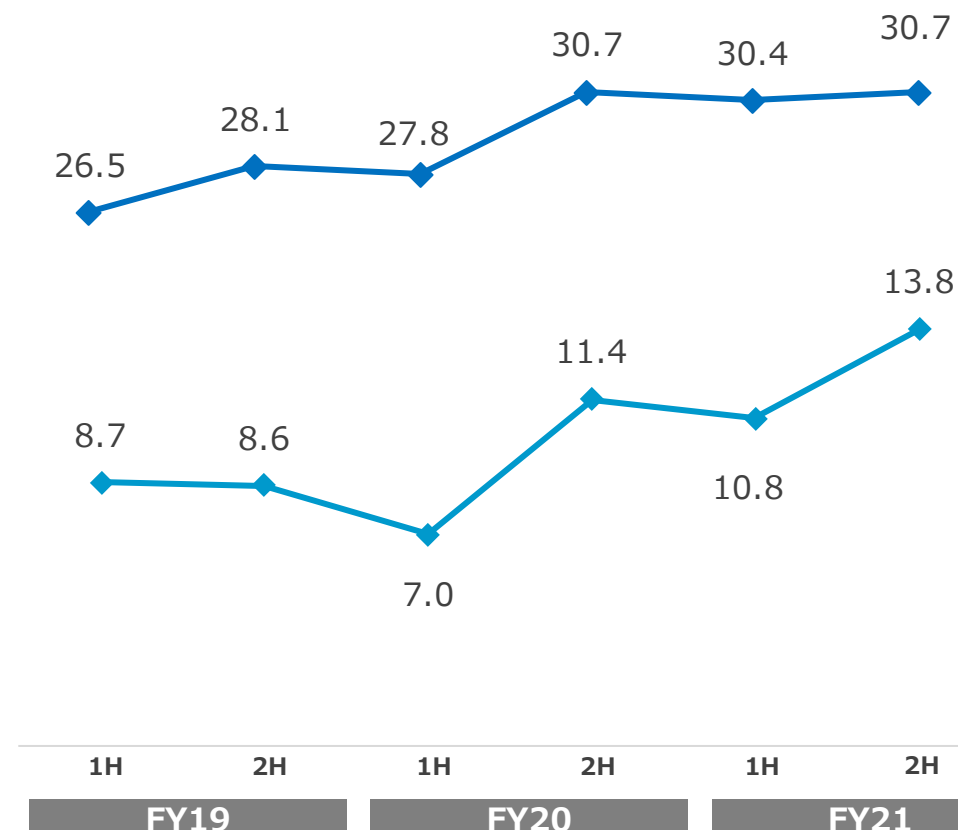
■ 売上高 ■ 営業利益



## 売上総利益率・営業利益率

【単位：%】

◆ 売上総利益率 ◆ 営業利益率

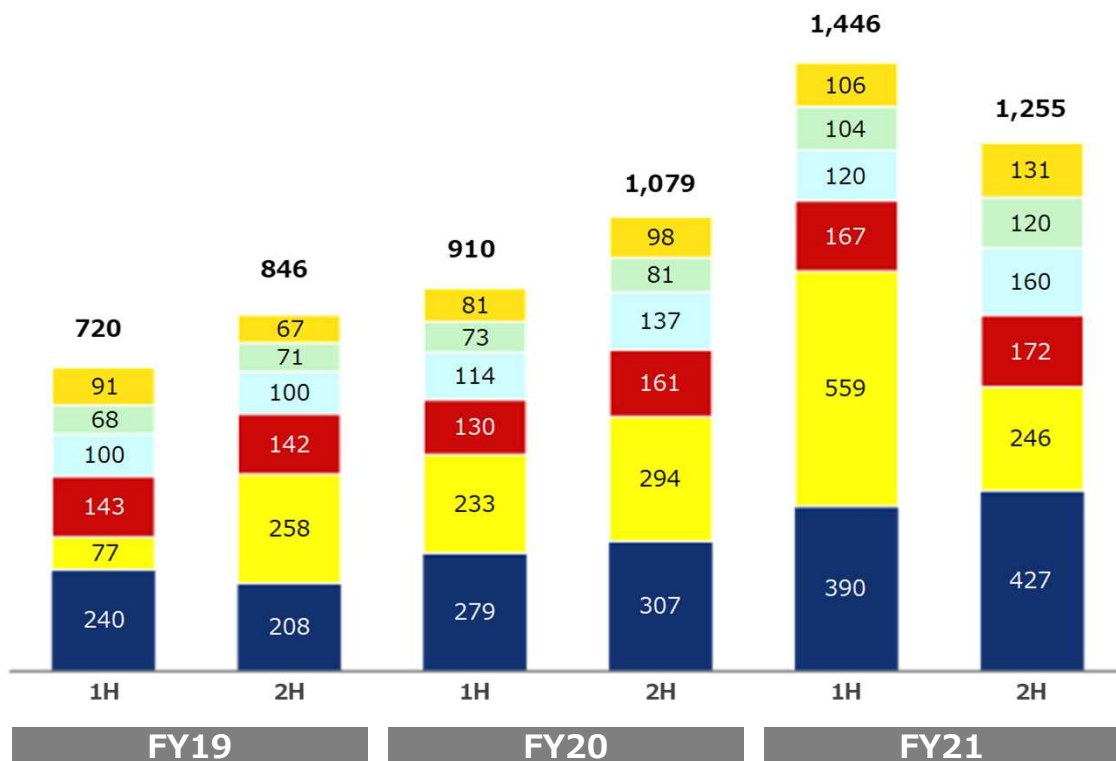




# 品目別受注高・売上高推移（半期）

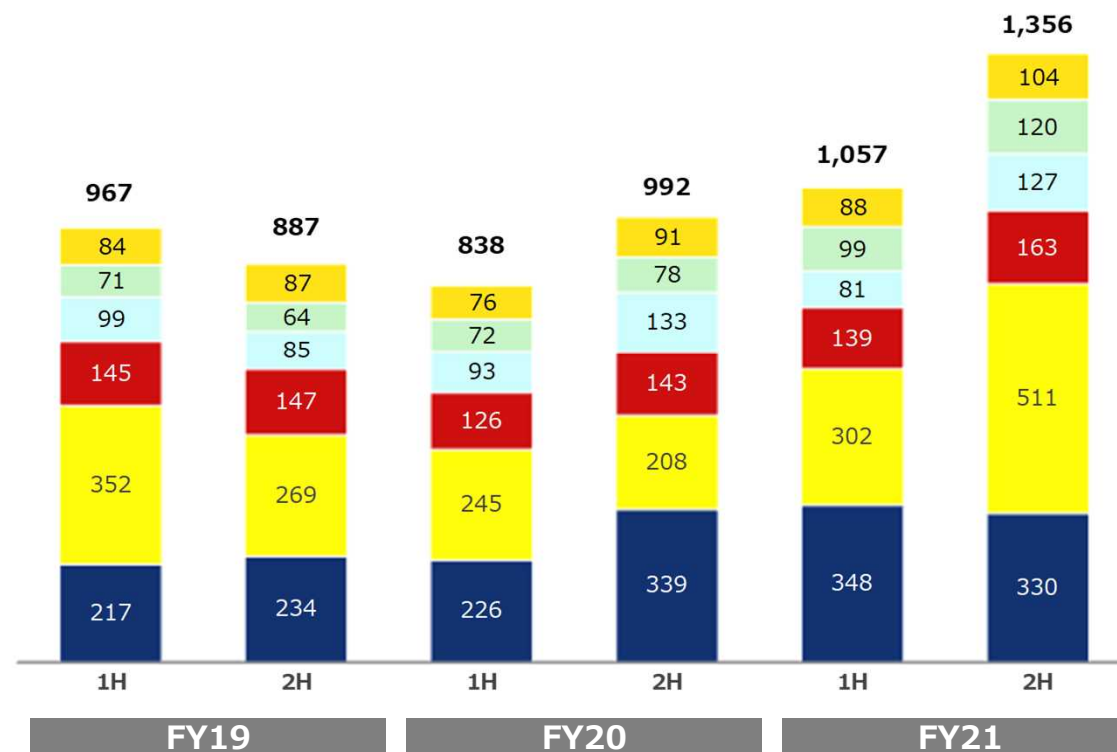
## 受注高 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



## 売上高 【単位：億円】

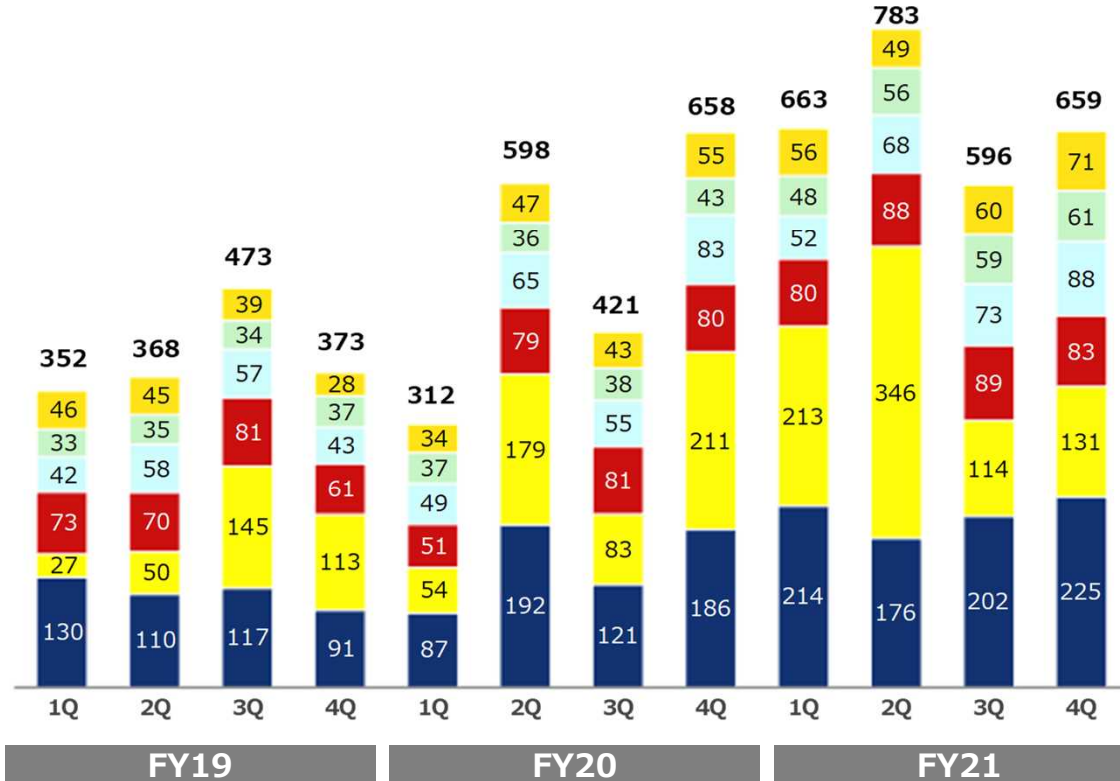
- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



# 品目別受注高・売上高推移（四半期）

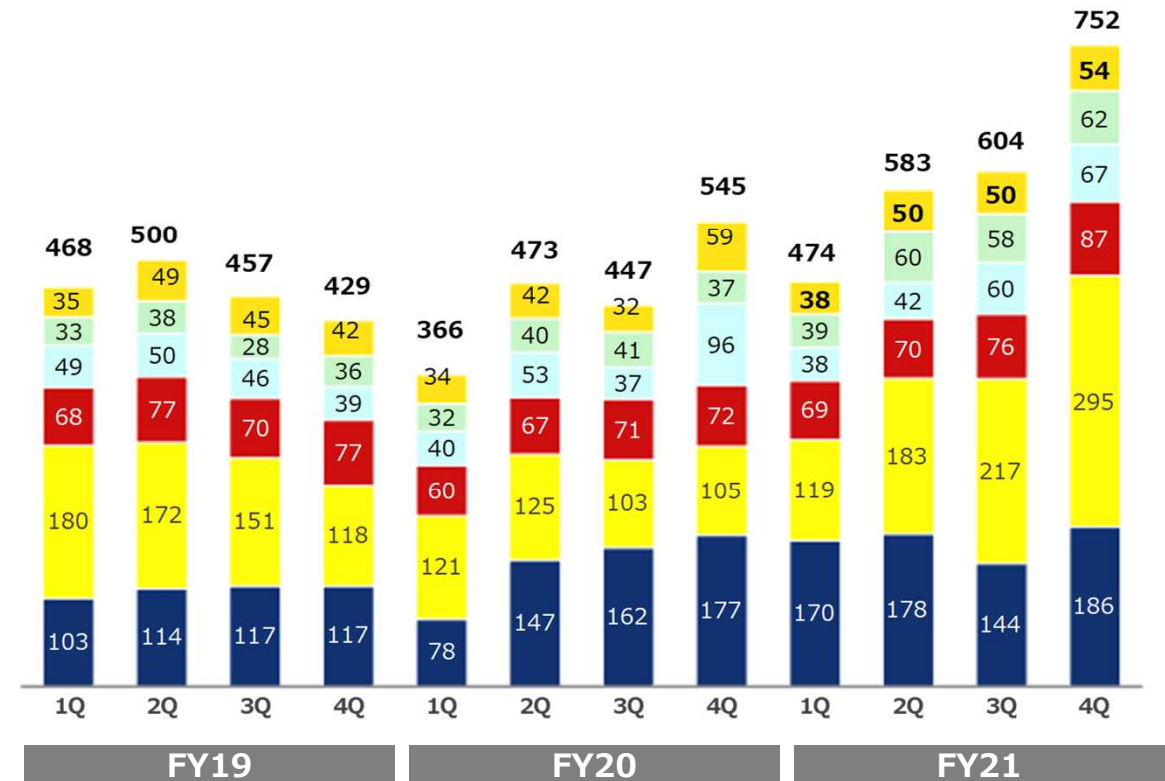
## 受注高 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



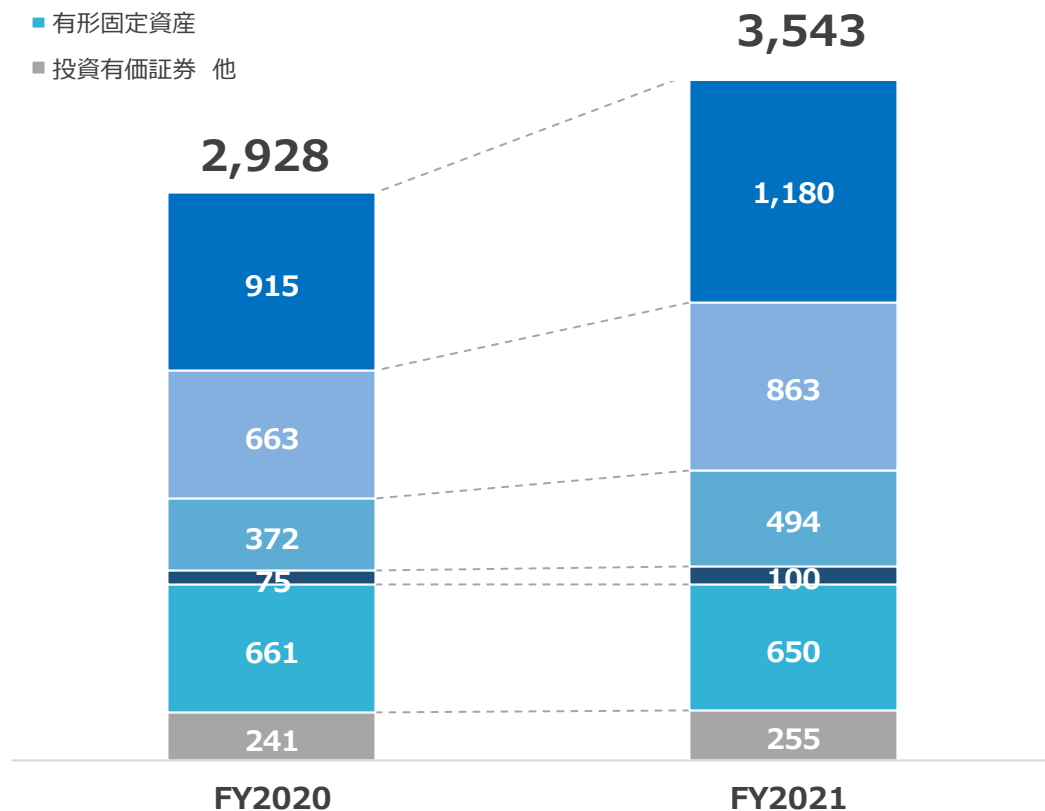
## 売上高 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



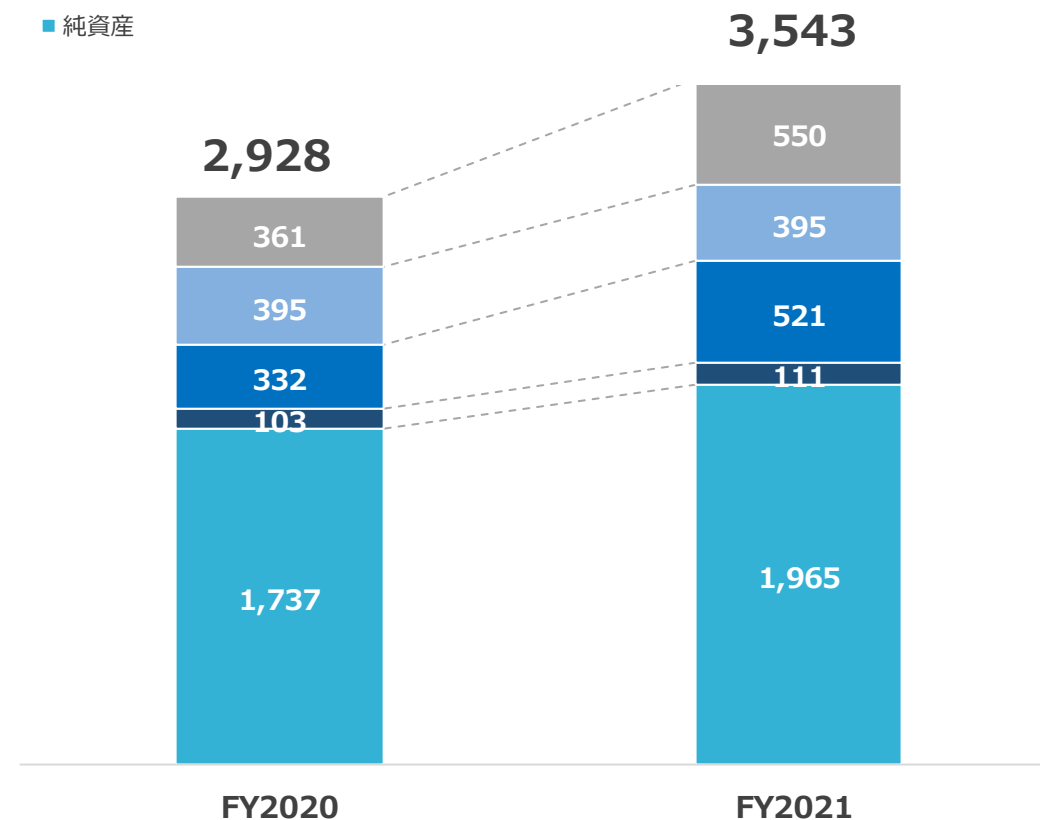
## 資産 【単位：億円】

- 現金・預金
- 受取手形・売掛金
- 棚卸資産
- その他の流動資産
- 有形固定資産
- 投資有価証券 他



## 負債・純資産 【単位：億円】

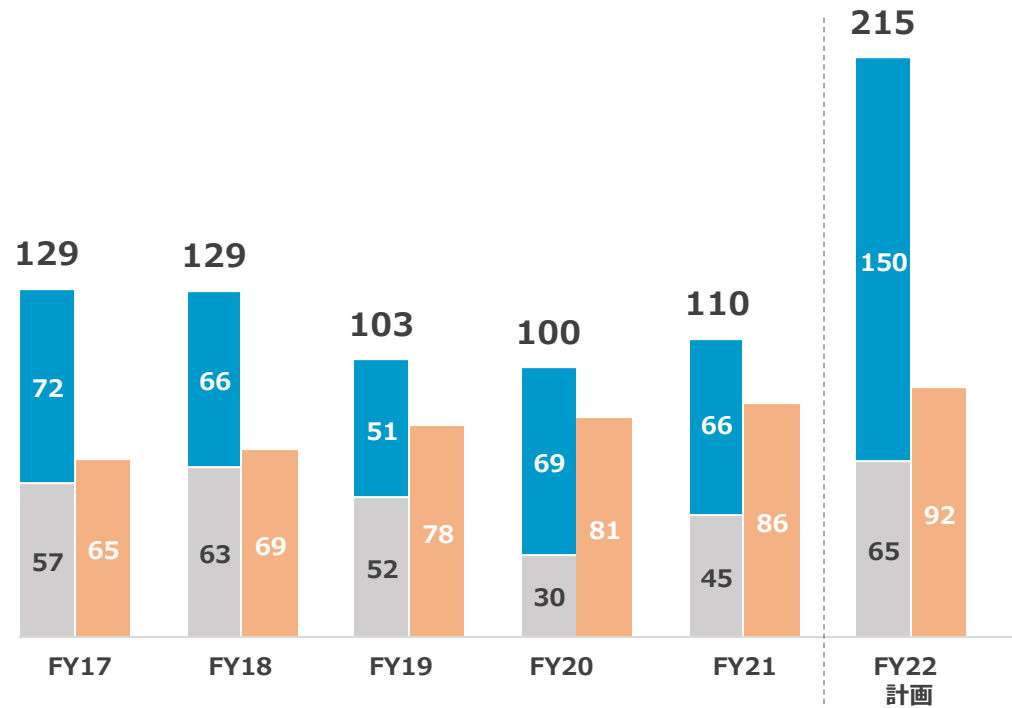
- 支払手形・買掛金
- 有利子負債
- その他流動負債
- その他固定負債
- 純資産



## 設備投資の推移・計画

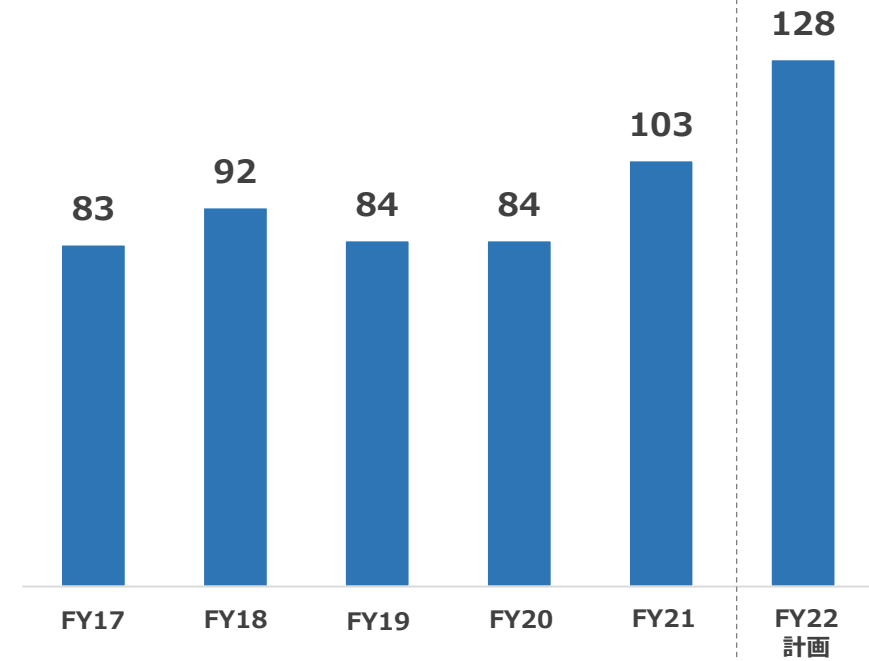
【単位：億円】

- 建物・生産設備等
- 研究開発設備
- 減価償却費



## 研究開発費の推移・計画

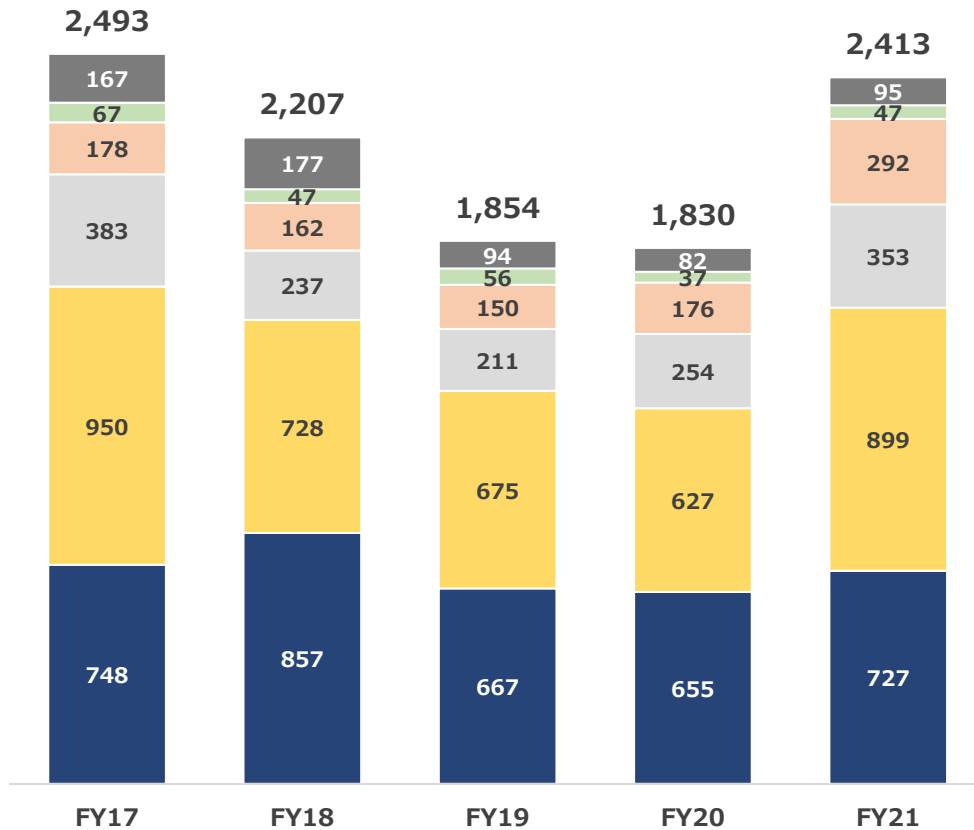
【単位：億円】



## 売上高

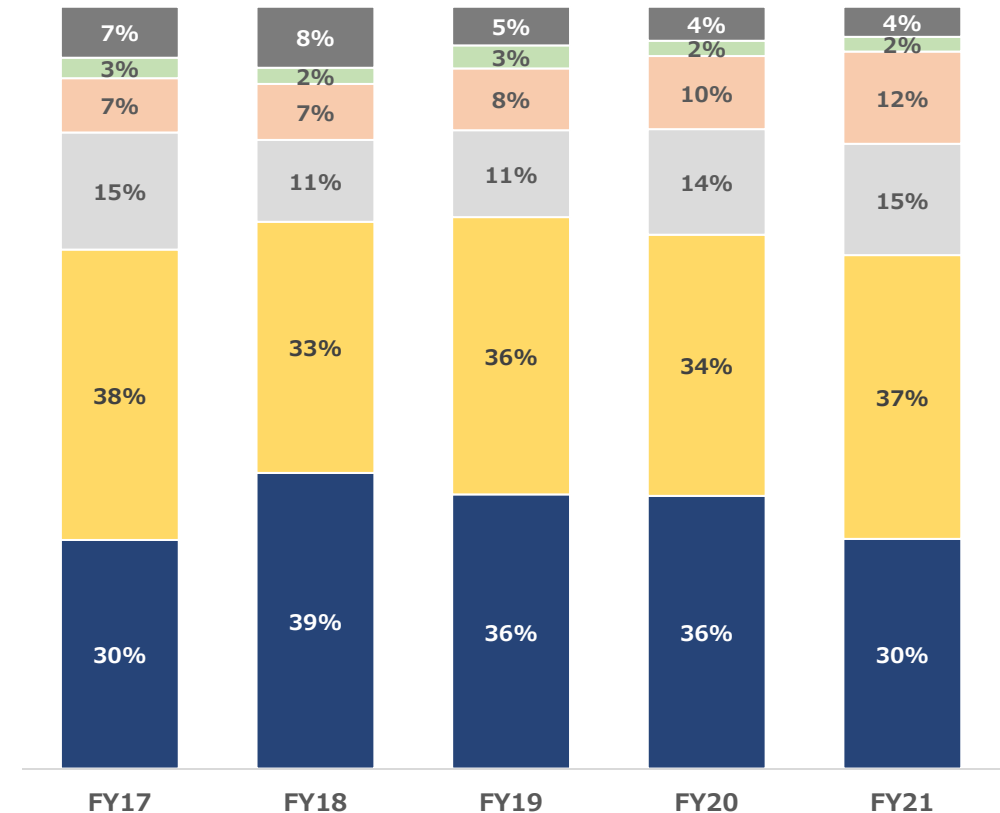
【単位：億円】

■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他 ■ 合計



## 売上高比率

■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他



# さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術



ULVAC